

PY32F071-E 系列数据手册

32 位 ARM[®] Cortex[®]-M0+ 微控制器



Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.

产品特性

- 内核
 - 32 位 ARM® Cortex® - M0+
 - 最高 72 MHz 工作频率
- 存储器
 - 最大 128 KB Flash 存储器
 - 最大 16 KB SRAM
- 时钟系统
 - 内部高速时钟(HSI) 4/8/16/22.12/24 MHz
 - 内部低速时钟(LSI) 32.768 kHz
 - 外部高速晶振(HSE) 4 ~ 32 MHz
 - 外部低速晶振(LSE) 32.768 kHz
 - PLL 支持对 HSI 或 HSE 的 2 倍频及 3 倍频
- 电源管理和复位
 - 工作电压: 1.7 ~ 5.5 V
 - 低功耗模式: 睡眠 (Sleep) 模式和停机 (Stop) 模式
 - 上电/掉电复位 (POR/PDR)
 - 欠压复位(BOR)
 - 可编程的电压检测 (PVD)
- 通用输入输出(I/O)
 - 多达 58 个 I/O, 均可作为外部中断
- 7 通道 DMA 控制器
- 1 x 12 位 ADC
 - 支持最多 16 个外部输入通道
 - 输入电压转换范围: 0 ~ V_{REF+}
- 2 x 12 位 DAC, 支持 2 个通道
- 3 路比较器
- 3 路运算放大器
- 支持 8 * 36 / 4 * 40 LCD
- 13 个定时器
 - 1 个 16 位高级控制定时器 (TIM1)
 - 1 个 32 位通用定时器 (TIM2)
 - 5 个 16 位通用定时器 (TIM3/14/15/16/17)
 - 2 个基本定时器(TIM6/TIM7)
 - 1 个低功耗定时器(LPTIM), 支持从低功耗模式唤醒
 - 1 个独立看门狗定时器 (IWDG)
 - 1 个窗口看门狗定时器 (WWDG)
 - 1 个 SysTick 定时器
- RTC
- 通讯接口
 - 2 个串行外设接口(SPI), 带 I²S 功能
 - 4 个通用同步/异步收发器(USART), 支持自动波特率检测, 其中 2 个支持 ISO7816, LIN, IrDA
 - 2 个 I²C 接口, 支持标准模式 (100 kHz)、快速模式 (400 kHz), 支持 7 位/10 位寻址模式, 其中一个支持 SMBus/PMBus
 - 1 路 USB 2.0 全速接口
- 硬件 CRC - 32 模块
- 32 位硬件除法器 (DIV)
- 唯一 UID
- 串行调试 (SWD)
- 工作温度:
 - -40 ~ 85 °C(x6 版本)
 - -40 ~ 105 °C(x7 版本)
- 封装: LQFP64、QFN64、LQFP48、QFN48、QFN32(4*4)、QFN24

目录

产品特性	2
1. 简介	6
2. 功能概述	9
2.1. Arm® Cortex®-M0+ 内核	9
2.2. 存储器	9
2.3. Boot 模式	9
2.4. 时钟系统	10
2.5. 电源管理	11
2.5.1. 电源框图	11
2.5.2. 电源监控	11
2.5.3. 电压调节器	13
2.5.4. 低功耗模式	13
2.6. 复位	13
2.6.1. 电源复位	13
2.6.2. 系统复位	14
2.7. 通用输入输出 GPIO	14
2.8. DMA	14
2.9. 中断	14
2.9.1. 中断控制器 NVIC	15
2.9.2. 扩展中断 EXTI	15
2.10. 模数转换器 ADC	15
2.11. 数模转换器 (DAC)	16
2.12. 比较器 (COMP)	16
2.13. 运算放大器(OPA)	17
2.14. LCD 控制器(LCD)	17
2.15. 硬件除法器(DIV)	17
2.16. 定时器	18
2.16.1. 高级定时器	18
2.16.2. 通用定时器	19
2.16.3. 基本定时器 TIM6/TIM7	19
2.16.4. 低功耗定时器 LPTIM	19
2.16.5. IWDG	19
2.16.6. WWDG	20
2.16.7. SysTick 定时器	20
2.17. 实时时钟 RTC	20
2.18. 循环冗余校验计算单元 CRC	20
2.19. 时钟校验系统 CTC	20

2.20. 系统配置控制器 SYSCFG	21
2.21. 调试支持 (DBG)	21
2.22. I ² C 接口	21
2.23. 通用同步异步收发器 USART	22
2.24. 串行外设接口 SPI	23
2.25. USB 2.0 全速模块	24
2.26. SWD	24
3. 引脚配置	25
3.1. 端口 A 复用功能映射	43
3.2. 端口 B 复用功能映射	44
3.3. 端口 C 复用功能映射	45
3.4. 端口 F 复用功能映射	46
4. 存储器映射	47
5. 电气特性	51
5.1. 测试条件	51
5.1.1. 最小值和最大值	51
5.1.2. 典型值	51
5.1.3. 供电方案	51
5.2. 绝对最大额定值	52
5.3. 工作条件	52
5.3.1. 通用工作条件	52
5.3.2. 上下电工作条件	53
5.3.3. 内嵌复位和 PVD 模块特性	53
5.3.4. 工作电流特性	54
5.3.5. 低功耗模式唤醒时间	56
5.3.6. 外部时钟源特性	56
5.3.7. 内部高频时钟源 HSI 特性	59
5.3.8. 内部低频时钟源 LSI 特性	59
5.3.9. 锁相环 PLL 特性	59
5.3.10. 存储器特性	60
5.3.11. EFT 特性	60
5.3.12. ESD & LU 特性	60
5.3.13. 端口特性	61
5.3.14. ADC 特性	61
5.3.15. DAC 特性	63
5.3.16. 比较器特性	64
5.3.17. 运算放大器特性	64
5.3.18. 温度传感器特性	65
5.3.19. LCD 控制器特性	65

5.3.20. 内置参考电压特性	65
5.3.21. ADC 内置参考电压特性	66
5.3.22. 定时器特性	66
5.3.23. 通讯口特性	67
6. 封装信息	72
6.1. LQFP64 封装尺寸	72
6.2. QFN64 封装尺寸	73
6.3. LQFP48 封装尺寸	74
6.4. QFN48 封装尺寸	75
6.5. QFN32(4*4)封装尺寸	76
6.6. QFN24 封装尺寸	77
7. 订购信息	78
8. 版本历史	79

1. 简介

PY32F071-E 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+ 内核，宽电压工作范围的 MCU。嵌入高达 128 KB Flash 和 16 KB SRAM 存储器，最高工作频率 72 MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路 I²C、SPI、USART 等通讯外设，1 路 12 位 ADC，2 路 DAC，13 个定时器，1 个 USB 2.0，3 路比较器，3 路运算放大器，1 个 LCD 驱动器。

PY32F071-E 系列微控制器的工作温度范围为 -40 ~ 85 °C 或 -40 ~ 105 °C，工作电压范围 1.7 ~ 5.5 V。芯片提供睡眠 (Sleep) 和停机 (Stop) 两种低功耗工作模式，可以满足不同的低功耗应用。

PY32F071-E 系列微控制器适用于多种应用场景，例如控制器、手持设备、PC 外设、游戏、GPS 平台和工业应用等。

表 1-1 PY32F071-E 系列产品规划及特征

外设	PY32F071R1B T7-E	PY32F071R1B U7-E	PY32F071C1B T7-E	PY32F071C18 T7-E	PY32F071C1B U7-E	PY32F071C1B U6-E	PY32F071K3B U7-E	PY32F071K38 U7-E	PY32F071E18 U7-E
Flash (KB)	128	128	128	64	128	128	128	64	64
SRAM (KB)	16	16	16	8	16	16	16	8	8
定时器	高级定时器				1 (16-bit)				
	通用定时器				5 (16-bit)				
	基本定时器				1(32-bit)				
	低功耗定时器				2				
	SysTick				1				
	看门狗				1				
接口	SPI[I ² S]				2[2]				
	I ² C				2				
	USART				4				
	USB				1				
DMA					7ch				
RTC					Yes				
通用端口	58	58	42	42	42	42	28	28	21
ADC (外部+ 内部通道)	1 (16 + 8)	1 (16 + 8)	1 (10 + 8)	1 (10 + 8)	1 (10+8)	1 (10 + 8)	1 (10 + 7)	1 (10 + 7)	1 (7+7)
DAC(通道数)					2 (2)				
模拟比较器					3				
放大器			3					2	
LCD 控制器					8*36 / 4*40				
最高主频					72 MHz				
工作电压					1.7 ~ 5.5 V				
工作温度			-40 ~ 105 °C		-40 ~ 85 °C		-40 ~ 105 °C		
封装	LQFP64	QFN64	LQFP48	LQFP48	QFN48	QFN48	QFN32(4*4)	QFN24	

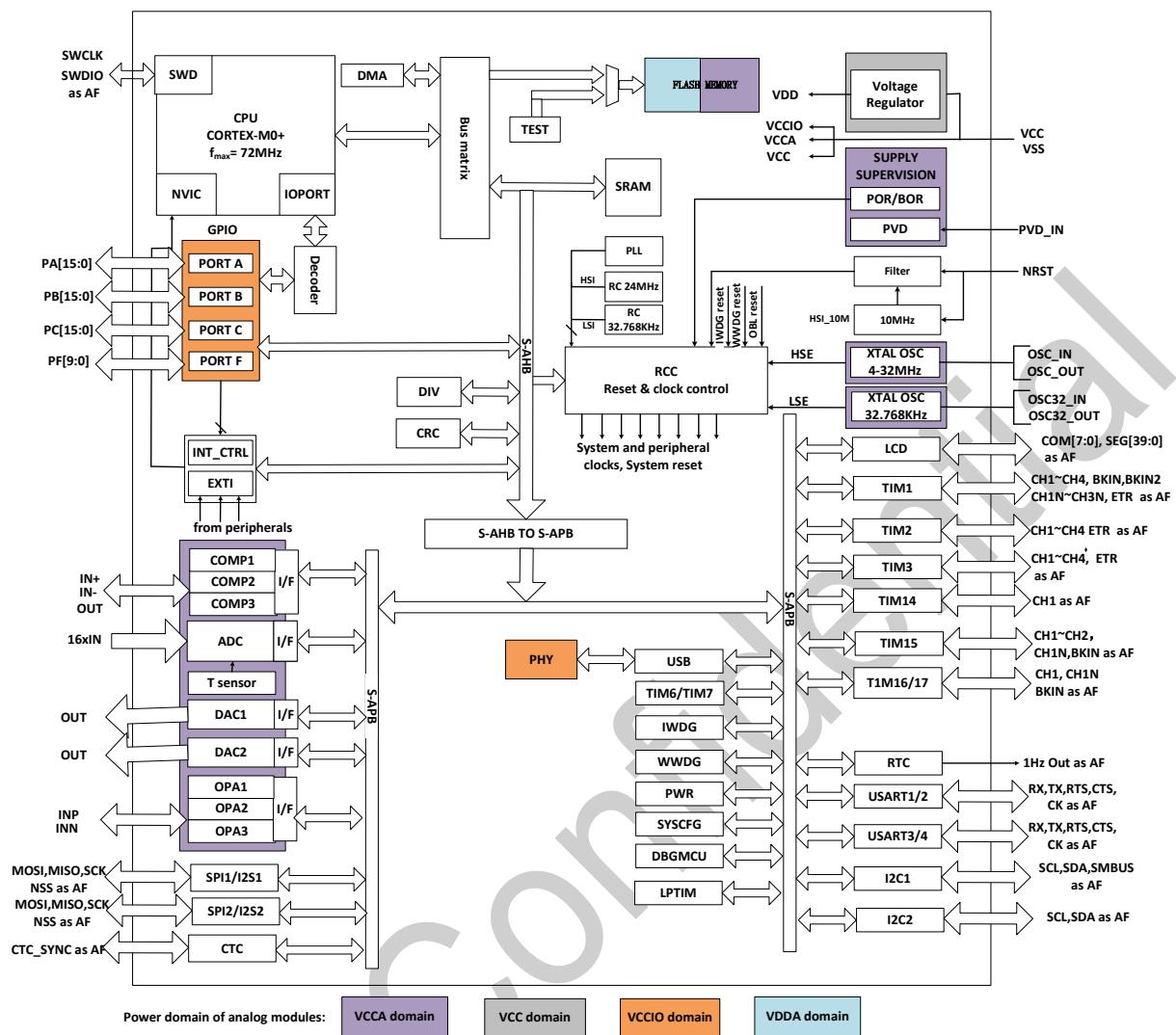


图 1-1 功能模块

2. 功能概述

2.1. Arm® Cortex®-M0+ 内核

Arm® Cortex® - M0+ 是一款为广泛的嵌入式应用设计的入门级 32 位 Arm Cortex 处理器。它为开发人员提供了显著的好处，包括：

- 结构简单，易于学习和编程
- 超低功耗，节能运行
- 精简的代码密度等

Cortex - M0+ 处理器是 32 位内核，面积和功耗优化高，为 2 级流水的冯诺伊曼架构。处理器通过精简但强大的指令集和广泛优化的设计，提供高端处理硬件，包含单周期乘法器，提供了 32 位架构计算机所期望的卓越性能，比其他 8 位和 16 位微控制器具有更高的代码密度。

Cortex - M0+ 与一个嵌套的矢量中断控制器 (NVIC) 紧密耦合。

2.2. 存储器

片内集成 SRAM，通过字节 (8 位)、半字 (16 位) 或者字 (32 位) 的方式可访问 SRAM。

片内集成 Flash，包含两个不同的物理区域组成：

- Main flash 区域，它包含应用程序和用户数据
- Information 区域，14 KB，它包括以下部分：
 - FT info0 bytes
 - Option bytes
 - UID bytes
 - System memory

对 Main flash 区域的保护包括以下几种机制：

- 读保护 (RDP) 防止来自外部的访问。
- 写保护 (WRP) 控制，以防止不想要的写操作（由于程序存储器指针混乱）。写保护的最小保护单位为 8 KB。
- 选项字节写保护，专门的解锁设计。

2.3. Boot 模式

通过 BOOT0 pin 和 boot 配置位 nBOOT 存放于选项字节中，可选择三种不同的启动模式：

表 2-1 Boot 配置

Boot 模式配置		模式
nBOOT1 bit	BOOT0 pin	
X	0	选择 Main flash 作为启动区
1	1	选择 System memory 作为启动区
0	1	选择 SRAM 作为启动区

Boot loader 程序存储在 System memory，用于通过 USART、USB 接口下载 Flash 程序。

2.4. 时钟系统

CPU 启动后默认系统时钟频率为 HSI 8 MHz，在程序运行后可以重新配置系统时钟频率和系统时钟源。可以选择的时钟有：

- 一个 4/ 8/ 16/ 22.12/ 24 MHz 可配置的内部高精度 HSI 时钟。
- 一个 32.768 kHz 可配置的内部 LSI 时钟。
- 一个 4 ~ 32 MHz HSE 时钟。
- 一个 32.768 kHz LSE 时钟。
- PLL 时钟，PLL 源可以选择 HSI 和 HSE。

AHB 时钟可以基于系统时钟分频，APB 时钟可以基于 AHB 时钟分频。AHB 和 APB 时钟频率最高为 72 MHz。

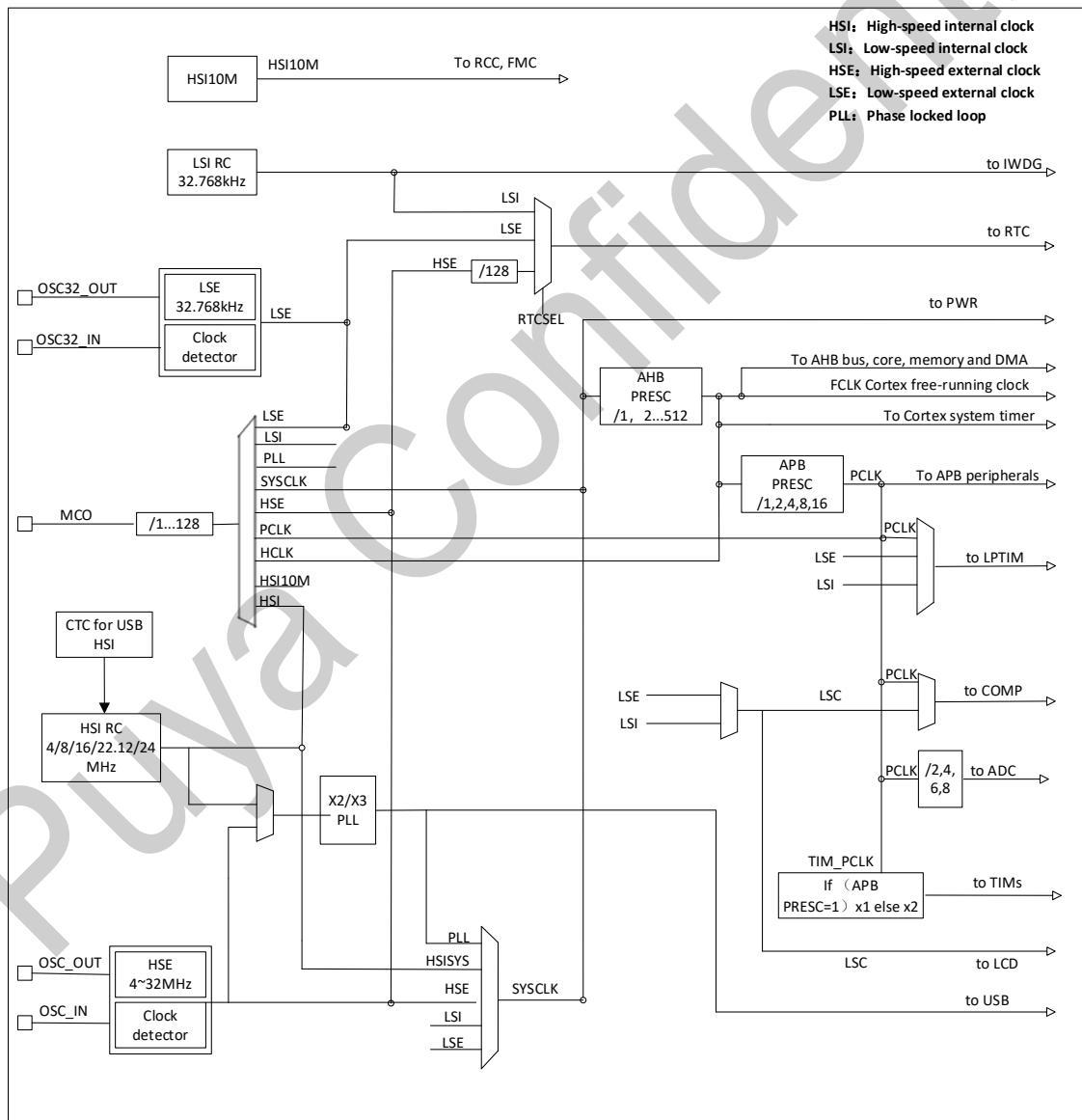


图 2-1 系统时钟结构图

2.5. 电源管理

2.5.1. 电源框图

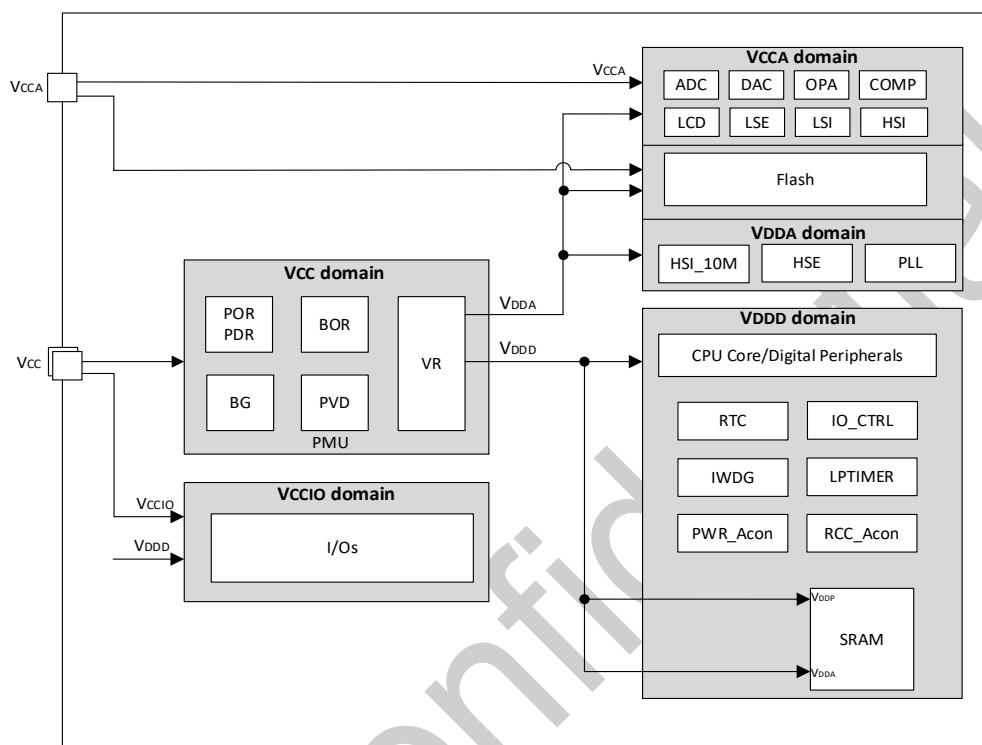


图 2-2 电源框图

表 2-2 电源框图

编号	电源	电源值	描述
1	V_{CC}	1.7 ~ 5.5 V	通过电源管脚为芯片提供电源。
2	V_{CCA}	1.7 ~ 5.5 V	通过电源管脚为芯片模拟电路提供电源。
3	V_{DDx} (V_{DDD}/V_{DDA})	1.2 V	来自于 VR 的输出, 为芯片内部主要逻辑电路、SRAM 供电。当 MR 供电时, 输出 1.2 V。当进入停机模式时, 根据软件配置, 可以由 MR 或者 LPR 供电, 并根据软件配置决定 LPR 输出。

2.5.2. 电源监控

2.5.2.1. 上下电复位 (POR/PDR)

芯片内设计 Power on reset (POR) / Power down reset (PDR) 模块, 为芯片提供上电和下电复位。该模块在各种模式之下都保持工作。

2.5.2.2. 欠压复位 (BOR)

除了 POR/PDR 外, 还实现了 BOR (Brown out reset)。BOR 仅可以通过选项字节使能和关闭。当 BOR 被打开时, BOR 的阈值可通过选项字节进行选择, 且上升和下降检测点都可被单独配置。

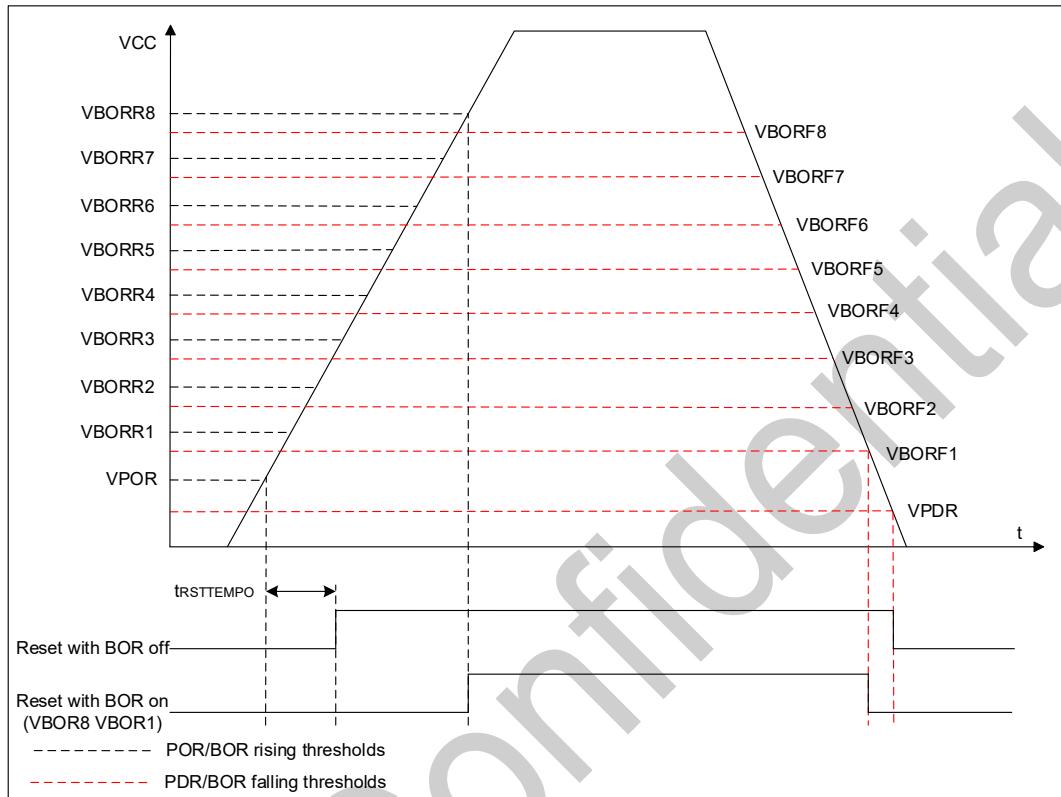


图 2-3 POR/PDR/BOR 阈值

2.5.2.3. 电压检测 (PVD)

电压检测 (PVD) 模块可以用来检测 V_{CC} 电源 (也可以检测 PB7 引脚的电压), 检测点可通过寄存器进行配置。当 V_{CC} 高于或低于 PVD 的检测点时, 产生相应的复位标识。

该事件内部连接到 EXTI 的 line 16, 取决于 EXTI line 16 上升/下降沿配置, 当 V_{CC} 上升超过 PVD 的检测点, 或者 V_{CC} 降低到 PVD 的检测点以下, 产生中断, 在中断服务程序中用户可以进行紧急的 shutdown 任务。

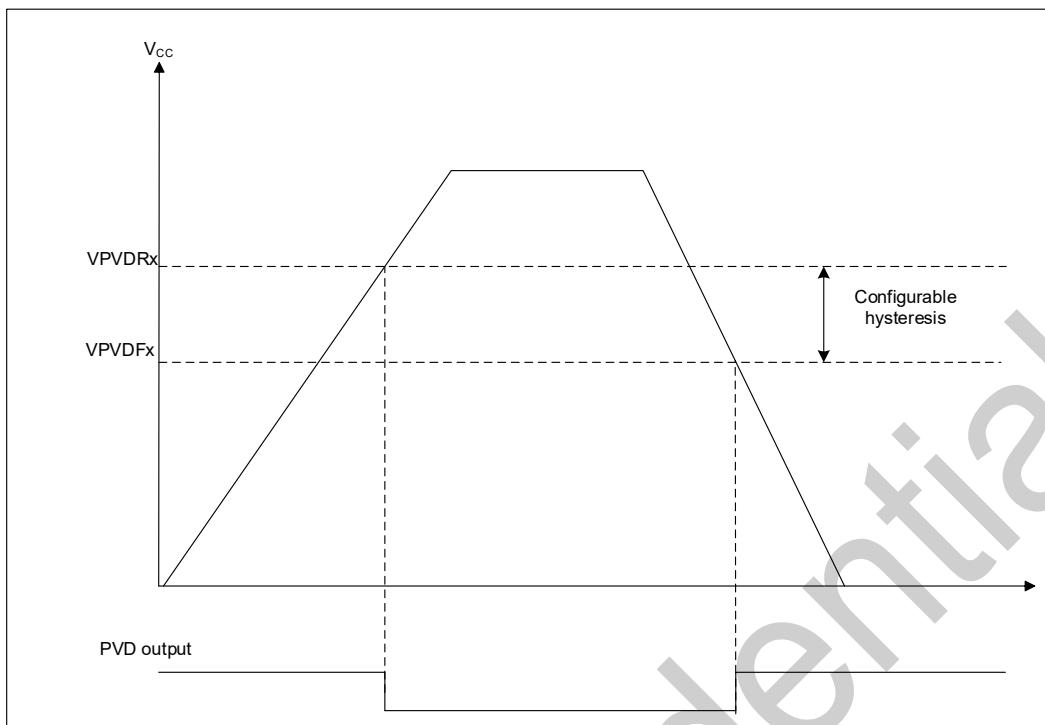


图 2-4 PVD 阈值

2.5.3. 电压调节器

芯片设计两个电压调节器：

- MR (Main regulator) 在芯片正常运行状态时保持工作。
- LPR (Low power regulator) 在停机模式下，提供更低功耗的选择。

2.5.4. 低功耗模式

芯片在正常的运行模式之外，有 2 个低功耗模式：

- 睡眠 (Sleep) 模式：CPU 时钟关闭 (NVIC, SysTick 等工作)，外设可以配置为保持工作。
(建议只使能必须工作的模块，在模块工作结束后关闭该模块)
- 停机 (Stop) 模式：该模式下 SRAM 和寄存器的内容保持，高速时钟 PLL、HSI 和 HSE 关闭， V_{DD} 域下大部分模块时钟都被停掉。GPIO, PVD, COMP output, RTC 和 LPTIM 可以唤醒停机模式。

2.6. 复位

芯片内设计两种复位，分别是：电源复位和系统复位。

2.6.1. 电源复位

电源复位在以下几种情况下产生：

- 上下电复位 (POR / PDR)
- 欠压复位 (BOR)

2.6.2. 系统复位

当产生以下事件时，产生系统复位：

- NRST pin 的复位
- 窗口看门狗复位 (WWDG)
- 独立看门狗复位 (IWDG)
- SYSRESETREQ 软件复位
- Option byte load 复位 (OBL)

2.7. 通用输入输出 GPIO

每个 GPIO 都可以由软件配置为输出 (push - pull 或者 open drain) , 输入 (floating, pull – up / down, analog) , 外设复用功能, 锁定机制会冻结 I/O 口配置功能。

2.8. DMA

直接存储器存取(DMA)用来提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输。搬移数据无需 CPU 干预, 数据可以通过 DMA 快速地移动, 这就节省了 CPU 的资源来做其他操作。DMA 控制器有 7 个通道, 每个通道专门用来管理来自于一个或多个外设对存储器访问的请求。还有一个仲裁器来协调各个 DMA 请求的优先权。

主要功能如下：

- 单 AHB Master
- 支持外设到存储器, 存储器到外设, 存储器到存储器和外设到外设的数据传输
- 片上存储器设备, 如 Flash, SRAM, AHB 和 APB 外设, 作为源和目标
- 所有 DMA 通道均可独立配置：
 - 每个通道要么与来自外设的 DMA 请求信号相关联, 要么与存储器到存储器传输中的软件触发器相关联。这个配置是由软件完成的。
 - 请求之间的优先级可通过软件编程实现 (每个通道 4 级：非常高、高、中、低) , 在相等的情况下由硬件可编程(例如对通道 1 的请求比对通道 2 的请求优先)。
 - 源和目标的传输大小是独立的(字节, 半字, 字), 模拟打包和拆包。源地址和目标地址必须按数据大小对齐。
 - 可编程传输数据数: 0 ~ 65535
- 每个通道生成一个中断请求。每个中断请求都是由三个 DMA 事件中的任何一个引起的：传输完成、半传输或传输错误。

2.9. 中断

PY32F071-E 通过 Cortex-M0+ 处理器内嵌的矢量中断控制器 (NVIC) 和一个扩展中断/事件控制器 (EXTI) 来处理异常。

2.9.1. 中断控制器 NVIC

NVIC 是 Cortex-M0+ 处理器内部紧耦合 IP。NVIC 可以处理来自处理器外部的 NMI (不可屏蔽中断) 和可屏蔽外部中断, 以及 Cortex-M0+ 内部异常。NVIC 提供了灵活的优先级管理。

处理器核心与 NVIC 的紧密耦合大大减少了中断事件和相应中断服务例程(ISR)启动之间的延迟。ISR 向量列在一个向量表中, 存储在 NVIC 的一个地址中。要执行的 ISR 的向量地址是由向量表地址和用作偏移量的 ISR 序号组成的。

如果高优先级的中断事件发生, 而低优先级的中断事件刚好在等待响应, 稍后到达的高优先级的中断事件将首先被响应。另一种优化称为尾链 (tail-chaining)。当从一个高优先级的 ISR 返回时, 然后启动一个挂起的低优先级的 ISR, 将跳过不必要的处理器上下文的压栈和弹栈。这减少了延迟, 提高了电源效率。

NVIC 特性:

- 低延时中断处理
- 4 级中断优先级
- 支持 1 个 NMI 中断
- 32 个可屏蔽的中断通道 (不包括 CPU 的中断)
- 高优先级中断可打断低优先级中断响应
- 支持尾链(tail - chaining)优化
- 硬件中断向量检索

2.9.2. 扩展中断 EXTI

EXTI 增加了处理物理线事件的灵活性, 系统可以通过 GPIO 和指定模块 (PVD/COMP/RTC/LPTIM) 输入事件唤醒。

EXTI 控制器有多个通道, 包括最多 58 个 GPIO 通过复用的方式使用 16 个 EXTI line, 1 个 PVD 输出, 3 个 COMP 输出, 以及 RTC 和 LPTIM 唤醒信号。其中 GPIO, PVD, COMP 可以配置上升沿、下降沿或双沿触发。任何 GPIO 信号通过选择信号配置为 EXTI0 ~ 15 通道。

- 每个 EXTI line 都可以通过寄存器独立屏蔽。
- EXTI 控制器可以捕获比内部时钟周期短的脉冲。
- EXTI 控制器中的寄存器锁存每个事件, 即使是在停机模式下, 处理器从停止模式唤醒后也能识别唤醒的来源, 或者识别引起中断的 GPIO 和事件。

2.10. 模数转换器 ADC

芯片具有 1 个 12 位的 SAR-ADC。该模块最多支持 24 个转换通道, 包括 16 个外部通道和 8 个内部通道。参考电压可选择片内电压 (1.5 V、2.048 V、2.5 V) 或 V_{CCA} 电源。

内部通道包括: T_{S_VIN}, V_{REFINT}, V_{CCA}/3, OPA 1~3, DAC 1~2。

- 各通道的转换模式可以设定为单次、连续、扫描、不连续模式。转换结果存储在左对齐或者右对齐的 16 位数据寄存器中。
- 模拟看门狗允许应用检测是否输入电压超出了用户定义的高或者低阈值。

- ADC 实现了在低频率下运行，可获得很低的功耗。
- 模拟看门狗开启时，在采样结束、转换结束、连续转换结束，若转换电压超出阈值，则会产生中断请求。

2.11. 数模转换器 (DAC)

数字/模拟转换模块(DAC)是 12 位数字输入，电压输出的数字/模拟转换器。DAC 可以配置为 8 位或 12 位模式，也可以与 DMA 控制器配合使用。DAC 工作在 12 位模式时，数据可以设置成左对齐或右对齐。DAC 模块有 2 个输出通道，每个通道都有单独的转换器。在双 DAC 模式下，2 个通道可以独立地进行转换，也可以同时进行转换并同步地更新 2 个通道的输出。主要特性如下：

- 12 位模式下数据左对齐或者右对齐
- 同步更新功能
- 噪声波形生成
- 三角波形生成
- 双 DAC 通道同时或者分别转换
- 每个通道都有 DMA 功能
- 支持 DMA 下溢错误检测
- 外部触发转换

2.12. 比较器 (COMP)

芯片内集成 3 个通用比较器 (General purpose comparators) COMP, COMP1/2/3。这 3 个模块可以作为单独的模块，也可以与 timer 组合在一起使用。

比较器可以被如下使用：

- 被模拟信号触发，产生低功耗模式唤醒功能
- 模拟信号调节
- 当与来自定时器的 PWM 输出连接时，cycle by cycle 的电流控制回路

主要特性如下：

- 支持电压比较功能，每个比较器有可配置的正或者负输入，以实现灵活的电压选择
 - 多路 I/O pin
 - $V_{CCA}/V_{REFBUF}/V_{REF1P2}$ 的 64 档分压
 - V_{REFINT}
 - 温度传感器输出
 - DAC 输出
 - OPA 输出
- 可编程速度和功耗
- Rail to Rail
- 迟滞功能
- 输出可以被连接到 I/O 或者 timer 的输入作为触发
- 每个 COMP 具有中断产生能力，用作芯片从低功耗模式（睡眠/停机）的唤醒（通过 EXTI）

- 提供软件可配置数字滤波时间以增强芯片抗干扰能力
- 支持 Window COMP 功能

2.13. 运算放大器(OPA)

OPA1/2/3 模块可以灵活配置，适用于简易放大器应用。内部的 3 个运放可以使用外部电阻进行级联。

OPA 功能概要如下：

- 3 个独立配置运放
- OPA 的输入范围是 $0 \sim V_{CCA}$ ，输出范围是 $0.2 \text{ V} \sim V_{CCA}-0.2 \text{ V}$ (以模拟模块需求为准)，可编程增益
- 可配置为以下模式
 - 通用运放模式 (General purpose OPA)

2.14. LCD 控制器(LCD)

LCD 控制器是一款适用于单色无源液晶显示器(LCD)的数字控制器/驱动器，最多具有 8 个公用端子 (COM) 和 40 个区段端子 (SEG)，用以驱动 160 ($4 * 40$) 或 288 ($8 * 36$) 个 LCD 像素。端子的确切数量取决于数据手册中所述的器件引脚。LCD 功能概要如下：

- 高度灵活的帧速率控制
- 支持静态、 $1/2$ 、 $1/3$ 、 $1/4$ 、 $1/6$ 和 $1/8$ 占空比
- 支持静态、 $1/2$ 、 $1/3$ 偏置电压
- 多达 16 个寄存器的 LCD 数据 RAM
- 可通过软件配置 LCD 的对比度
- 2 种驱动波形生成方式
 - 内部电阻分压、外部电阻分压
 - 可通过软件配置内部电阻分压方式的功耗，从而匹配 LCD 面板所需的电容电荷
- 支持低功耗模式：LCD 控制器可在运行、睡眠、停机模式下进行显示
- 可配置帧中断
- 支持 LCD 闪烁功能且可配置多种闪烁频率
- 未使用的 LCD 区段和公共引脚可配置为数字或模拟功能

2.15. 硬件除法器(DIV)

DIV (Divider) 是一个 32 位有符号/无符号整数硬件除法器。

DIV 主要特性如下：

- 支持 32 位除法
- 当前除法未运行完毕时，寄存器中的数据不可改变
- 可配置有符号/无符号整数除法计算
- 32 位被除数，32 位除数
- 输出 32 位商和 32 位余数
- 除数为零警告标志位，除法运算结束标志位

- 8 个时钟周期完成一次除法运算
- 写除数寄存器触发除法运算电路
- 写完除数后, 读商寄存器和余数等寄存器时, 需要先等待计算完成标志 DIV_END
- 除数为 0 时, 商和余数结果为 0

2.16. 定时器

PY32F071-E 不同定时器的特性如下表所示:

表 2-3 定时器特性

类型	定时器	位宽	计数方向	预分频	DMA	捕获/比较通道	互补输出
高级定时器	TIM1	16 位	递增、递减、中心对齐	1 ~ 65536	支持	4	3
通用定时器	TIM2	32 位	递增、递减、中心对齐	1 ~ 65536	支持	4	-
	TIM3	16 位	递增、递减、中心对齐	1 ~ 65536	支持	4	-
	TIM14	16 位	递增	1 ~ 65536	-	1	-
	TIM15	16 位	递增	1 ~ 65536	支持	2	1
	TIM16, TIM17	16 位	递增	1 ~ 65536	支持	1	1
基本定时器	TIM6, TIM7	16 位	递增	1 ~ 65536	支持	-	-

2.16.1. 高级定时器

高级定时器 (TIM1) 由 16 位被可编程分频器驱动的自动装载计数器组成。它可以被用作各种场景, 包括: 输入信号 (输入捕获) 的脉冲长度测量, 或者产生输出波形 (输出比较、输出 PWM、带死区插入的互补 PWM)。

TIM1 包括 4 个独立通道, 用作:

- 输入捕获
- 输出比较
- PWM 产生 (边缘或者中心对齐模式)
- 单脉冲模式输出

如果 TIM1 配置为标准的 16 位计时器, 则它具有与 TIMx 计时器相同的特性。如果配置为 16 位 PWM 发生器, 则具有全调制能力 (0 ~ 100%)。

在 MCU debug 模式, TIM1 可以冻结计数。

具有相同架构的定时器特性共享, 因此 TIM1 可以通过计时器链接功能与其他计时器一起工作, 以实现同步或事件链接。

TIM1 支持 DMA 功能。

2.16.2. 通用定时器

2.16.2.1. TIM2/TIM3

TIM2/TIM3 通用定时器是由 32/16 位可编程分频器驱动的 32/16 位自动重装载计数器构成。具有 4 个独立的通道，每个用于输入捕获/输出比较，PWM 或者单脉冲模式输出。

- 可以通过计时器链接功能与 TIM1 一起工作
- 支持 DMA 功能
- 能够处理正交(增量)编码器信号和数字输出从 1 到 3 霍尔效应传感器
- 在 MCU debug 模式，TIM2/TIM3 可以冻结计数

2.16.2.2. TIM14

- 通用定时器 TIM14 由可编程预分频器驱动的 16 位向上自动装载计数器构成
- TIM14 具有 1 个独立通道用于输入捕获/输出比较，PWM 或者单脉冲模式输出
- 在 MCU debug 模式，TIM14 可以冻结计数

2.16.2.3. TIM15/TIM16/TIM17

- TIM15、TIM16 和 TIM17 由可编程预分频器驱动的 16 位自动装载计数器构成
- TIM15 具有 2 个独立通道用于输入捕获/输出比较，PWM 或者单脉冲模式输出
- TIM16/TIM17 具有 1 个独立通道用于输入捕获/输出比较，PWM 或者单脉冲模式输出
- TIM15、TIM16/TIM17 具有带死区的互补输出
- TIM15、TIM16/TIM17 支持 DMA 功能
- 在 MCU debug 模式，TIM15、TIM16/TIM17 可以冻结计数

2.16.3. 基本定时器 TIM6/TIM7

- 基本定时器 TIM6/TIM7 包含一个 16 位自动装载计数器，由各自的可编程预分频器驱动
- 16 位自动装载计数器
- 触发 DAC 的同步电路
- 在更新事件（计数器溢出）发生时产生中断/DMA 请求

2.16.4. 低功耗定时器 LPTIM

- LPTIM 为 16 位向上计数器，包含 3 位预分频器。支持连续/单次模式
- LPTIM 可以配置为停机模式唤醒源
- 在 MCU debug 模式，LPTIM 可以冻结计数值

2.16.5. IWDG

芯片内集成了一个独立看门狗定时器（IWDG），该模块具有高安全级别、时序精确及灵活使用的特点。IWDG 发现并解决由于软件失效造成的功能混乱，并在计数器达到指定的 timeout 值时触发系统复位。

- IWDG 由独立的 RC 振荡器提供时钟，可在停机模式下工作
- IWDG 最适合需要看门狗作为主应用之外的独立过程，并且无很高的时序准确度限制的应用
- 通过选项字节的控制，可以使能 IWDG 硬件模式
- IWDG 是停机模式的唤醒源，以复位的方式唤醒停机模式
- 在 MCU debug 模式，IWDG 可以冻结计数值

2.16.6. WWDG

系统窗口看门狗是基于一个 7 位的下行计数器，可以设置为自由运行。当出现问题时，它可以作为一个看门狗来复位系统。计数时钟为 APB 时钟 (PCLK)。它具有预警中断能力，计数器可以在 MCU debug 模式下被冻结。

2.16.7. SysTick 定时器

SysTick 计数器专门用于实时操作系统 (RTOS)，但也可以用作标准的向下计数器。

SysTick 特性：

- 24 位向下计数
- 自装载能力
- 计数器记到 0 时可产生中断 (可屏蔽)

2.17. 实时时钟 RTC

实时时钟是一个独立的定时器。RTC 模块拥有一组连续计数的计数器，在相应软件配置下，可提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。

- RTC 为预分频系数最高为 2^{20} 的 32 位可编程计数器
- RTC 计数器时钟源可以为 LSE、LSI 以及 HSE 时钟除以 128，可以作为 Stop 唤醒源
- RTC 可以产生闹钟中断，秒中断和溢出中断 (可屏蔽)
- RTC 支持时钟校准
- 在 MCU debug 模式，RTC 可以冻结计数

2.18. 循环冗余校验计算单元 CRC

循环冗余校验(CRC)计算单元是根据固定的生成多项式得到 32 位 CRC 计算结果。在其他的应用中，CRC 技术主要应用于核实数据传输或者数据存储的正确性和完整性。

2.19. 时钟校验系统 CTC

CTC 模块基于外部高精度的参考信号源来校准 HSI 的时钟频率，通过自动的或手动的调整校准值，以得到一个精准的 PLL 48 MHz 时钟。

CTC 模块主要完成如下功能：

- 三个外部参考信号源：GPIO，LSE 时钟，USBD_SOF
- 提供软件参考同步脉冲
- 硬件自动校准，无需软件操作

- 具有参考信号源捕获和重载功能的 16 位校准计数器
- 用于频率评估和自动校准的 8 位时钟校准基值
- 标志位和中断，用于指示时钟校准的状态：校准成功状态 (CKOKIF)，警告状态 (CKWARNIF) 和错误状态 (ERRIF)

2.20. 系统配置控制器 SYSCFG

SYSCFG 模块主要完成如下功能：

- I²C 类型 IO 滤波使能和关闭
- 根据不同 boot 模式，映射初始程序区
- DMA 外设通道选择控制。
- TIMx 级联控制
- PVD Lock 的使能与关闭
- Cortex-M0+ LOCKUP 的使能与关闭
- 所有 GPIO 的噪声滤波器的使能与关闭

2.21. 调试支持 (DBG)

MCU DBG 模块协助调试器提供以下功能：

- 支持睡眠模式，停止模式
- CPU 进入 HALT 时，控制定时器、看门狗停止计数或者继续计数
- CPU 进入 HALT 时，阻止 I²C1 和 I²C2 SMBUS 超时
- 分配跟踪引脚

MCUDBG 寄存器还提供芯片 ID 编码。使用 JTAG 或者 SW 调试接口，或者用户程序都可以访问此 ID 编码。

2.22. I²C 接口

I²C (Inter-integrated circuit) 总线接口连接微控制器和串行 I²C 总线。它控制所有 I²C 总线特定的顺序、协议、仲裁和时序。支持标准 (Sm) 、快速 (Fm) 。

I²C 特性：

- 可以做 Master，也可以做 Slave
- 支持不同通讯速度
 - 标准模式 (Sm)：高达 100 kHz
 - 快速模式 (Fm)：高达 400 kHz
- 作为 Master
 - 时钟产生
 - Start 和 Stop 的产生
- 作为 Slave
 - 可编程的 I²C 地址检测
 - 可响应 2 个从地址的双地址能力

- 停止条件的检测
- 7 位/10 位寻址模式
- 支持广播呼叫 (General call)
- 状态标志位
 - 发送/接收模式标志位
 - 字节传输完成标志位
 - I²C 总线忙标志位
- 错误标志位
 - 主机仲裁丢失
 - 地址/数据传输后的 ACK 失败
 - 起始和停止错误
 - 过载 (overrun) /欠载 (underrun) (时钟拉长功能禁止)
- 可选的时钟拉长功能
- 具备 DMA 能力的单字节 buffer
- 软件复位
- 模拟噪声滤波功能
- 可配置的 PEC (Packet error checking) 产生和验证
- 兼容 SMBus

2.23. 通用同步异步收发器 USART

PY32F071-E 包含 4 个 USART，2 个支持全功能的 USART (USART1 和 USART2)，两个不支持 LIN, SCEN, IrDA 的 USART (USART3 和 USART4)。

通用同步异步收发器 (USART) 提供了一种灵活的方法与使用工业标准 NRZ 异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。USART 利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。

它支持同步单向通信和半双工单线通信，它还允许多处理器通信。

支持自动波特率检测。

使用多缓冲器配置的 DMA 方式，可以实现高速数据通信。

USART 特性：

- 全双工异步通信
- NRZ 标准格式
- 可配置 16 倍或者 8 倍过采样，增加在速度和时钟容忍度的灵活性
- 发送和接收共用的可编程波特率，最高达 4.5 Mbit/s
- 自动波特率检测
- 可编程的数据长度 8 位或者 9 位
- 可配置的停止位 (支持 0.5, 1, 1.5 或 2 个停止位)
- 同步模式和为同步通讯的时钟输出功能
- 单线半双工通讯
- 独立的发送和接收使能位

- 硬件流控制
- 通过 DMA 缓冲接收/发送字节
- 检测标志
 - 接收 buffer 满
 - 发送 buffer 空
 - 传输结束
- 奇偶校验控制
 - 发送校验位
 - 对接收数据进行校验
- 带标志的中断源
 - CTS 改变
 - 发送寄存器空
 - 发送完成
 - 接收数据寄存器满
 - 检测到总线空闲
 - 溢出错误
 - 帧错误
 - 噪音操作
 - 校验错误
- 多处理器通信
 - 如果地址不匹配，则进入静默模式
- 从静默模式唤醒：通过空闲检测和地址标志检测，两种唤醒接收器的方式：地址位（MSB，第 9 位），总线空闲。

2.24. 串行外设接口 SPI

PY32F071-E 包含 2 个 SPI。串行外设接口(SPI)允许芯片与外部设备以半双工、全双工、单工同步的串行方式通信。此接口可以被配置成主模式，并为外部从设备提供通信时钟 (SCK)。接口还能以多主配置方式工作。

SPI 特性如下：

- Master 或者 Slave 模式
- 3 线全双工同步传输
- 2 线半双工同步传输（有双向数据线）
- 2 线单工同步传输（无双向数据线）
- 8 位或者 16 位传输帧选择
- 支持多主模式
- 8 个主模式波特率预分频系数（最大为 $f_{PCLK}/2$ ）
- 从模式频率（最大为 $f_{PCLK}/4$ ）
- 主模式和从模式下均可以由软件或硬件进行 NSS 管理：主/从操作模式的动态改变
- 可编程的时钟极性和相位

- 可编程的数据顺序, MSB 在前或 LSB 在前
- 可触发中断的专用发送和接收标志
- SPI 总线忙状态标志
- Motorola 模式
- 可引起中断的主模式故障、过载
- 2 个具备 DMA 能力的 32 位 Rx 和 Tx FIFOs

2.25. USB 2.0 全速模块

PY32F071-E 包含 1 个 USB 2.0 全速模块。USB 外设实现了 USB 2.0 全速总线和 APB1 总线间的接口。支持 USB 挂起/恢复操作, 可以停止设备时钟实现低功耗。主要特性如下:

- 符合 USB 2.0 全速设备的技术规范
- 可配置 1 到 6 个 USB 端点
- CRC(循环冗余校验)生成/校验, 反向不归零 (NRZI) 编码/解码和位填充
- 支持控制传输/同步传输/批量传输/中断传输
- 支持批量/同步端点的双缓冲区机制
- 支持 USB 挂起/恢复操作
- 帧锁定时钟脉冲生成
- 专用的 1024 字节的数据包缓存存储

2.26. SWD

ARM SWD 接口允许串口调试工具连接到 PY32F071-E。

3. 引脚配置

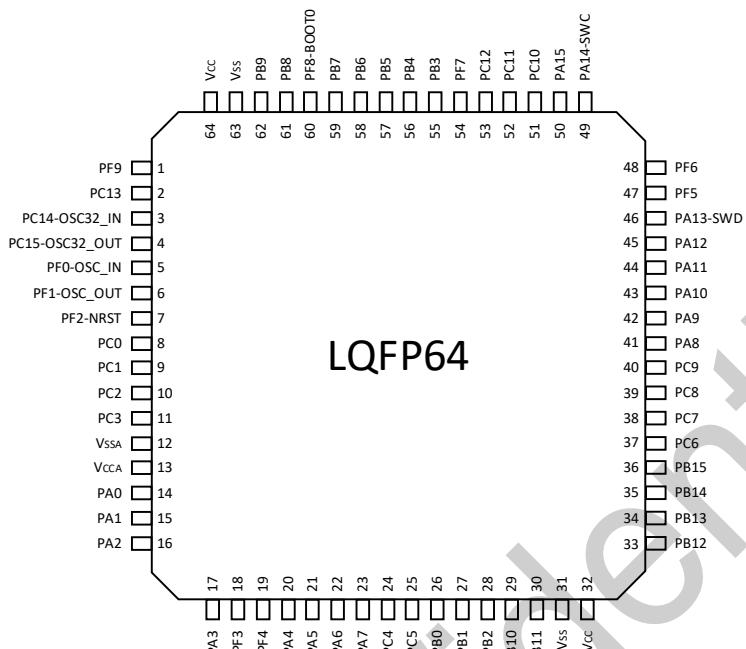


图 3-1 LQFP64 PY32F071R1xT7-E Pinout1 (Top view)

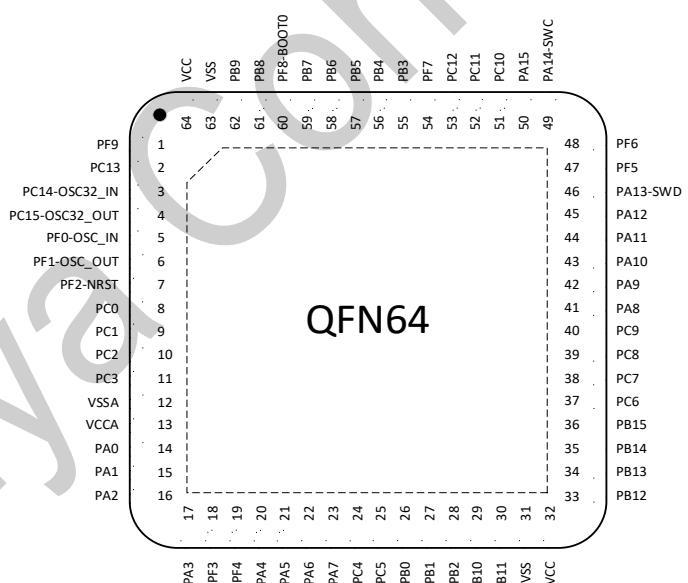


图 3-2 QFN64 PY32F071R1xU7-E Pinout1 (Top view)

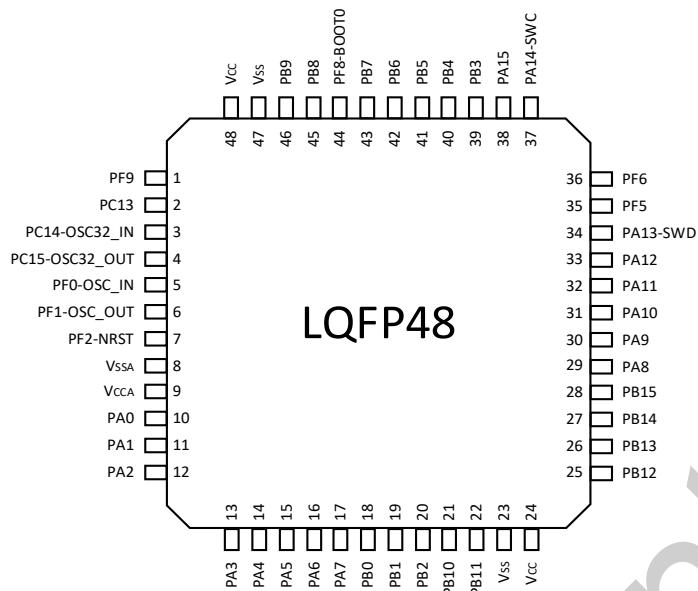


图 3-3 LQFP48 PY32F071C1xT7-E Pinout1 (Top view)

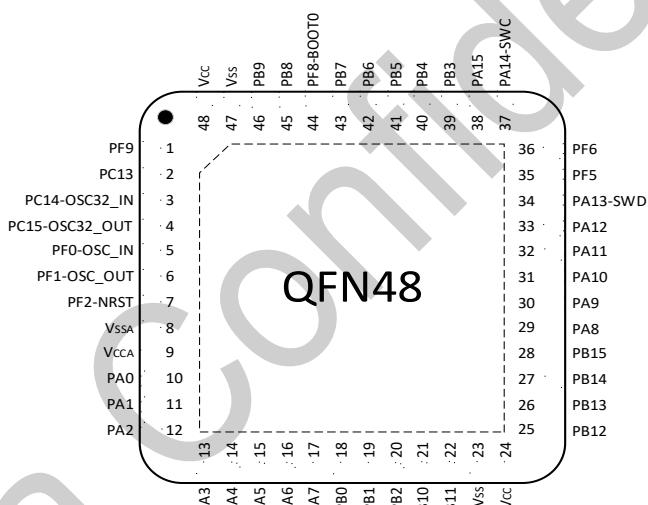


图 3-4 QFN48 PY32F071C1xUx-E Pinout1 (Top view)

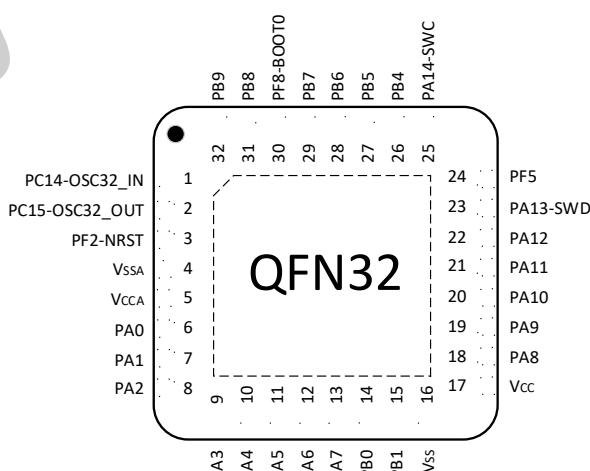


图 3-5 QFN32(4*4) PY32F071K3xU7-E Pinout3 (Top view)

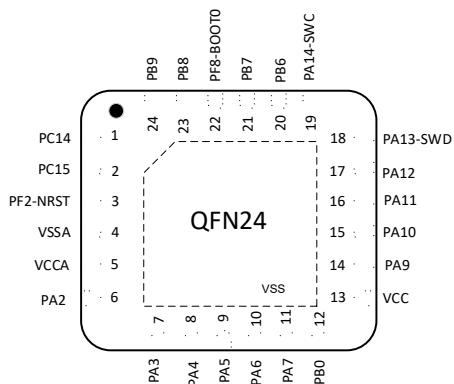


图 3-6 QFN24 PY32F071E1xU7-E Pinout1 (Top view)

表 3-1 引脚定义的术语和符号

类型	符号	定义
端口类型	S	Supply 引脚
	G	Ground 引脚
	I	Input - only 引脚
	I/O	Input/ output 引脚
	NC	无定义
端口结构	COM	正常 5V 端口, 支持模拟输入输出功能
	NRST	复位端口, 内部带弱上拉电阻, 不支持模拟输入输出功能
	COM_U	标准 5V 端口, 支持 USB 功能
注	-	除非有其他说明, 不然所有端口都被在复位之间和之后, 作为浮空的输入
端口功能	复用功能	通过 GPIOx_AFR 寄存器选择的功能
	附加功能	通过外设寄存器直接选择或使能的功能

表 3-2 引脚定义

封装						复位	端口类型	端口结构	注	端口功能	
LQFP64 R1	QFN64 R1	LQFP48 C1	QFN48 C1	QFN32 K3	QFN24 E1					复用功能	附加功能
1	1	1	1	-	-	PF9	I/O	COM		-	-
2	2	2	2	-	-	PC13	I/O	COM		SPI1_SCK/I ² S1_CK	-
3	3	3	3	1	1					TIM1_BKIN	
4	4	4	4	2	2	PC14	I/O	COM		TIM1_BKIN2	OSC32_IN
5	5	5	5	-	-	PC15 PF0-OSC_IN PF1-OSC_OUT	I/O	COM		TIM15_BKIN	OSC32_OUT OSC_IN
6	6	6	6	-	-					CTC_SYNC	
7	7	7	7	3	3					USART2_TX	
8	8	-	-	-	-					TIM1_BKIN	
						PF2-NRST	I/O	NRST	(1)	TIM14_CH1	
						PC0	I/O	COM		USART2_RX	OSC_OUT
										TIM1_CH1N	
										TIM15_CH1N	
										USART2_RX	
										TIM1_CH2	-
										EVENTOUT	
										MCO	
										EVENTOUT	
										SPI1_MISO/I ² S1_MCK	ADC_IN10, COMP1_INN15, COMP2_INN0, SEG27
										USART2_CTS	
										USART3_RTS	

封装							端口功能		
9	9	-	-	-	-	-	PC1	I/O	COM
								EVENTOUT	ADC_IN11, COMP1_INP1, COMP2_INN1, SEG26
								SPI1_MOSI/I ² S1_SD	
								USART2_RTS	
								USART3_CTS	
10	10	-	-	-	-	-	PC2	I/O	COM
								EVENTOUT	ADC_IN12, COMP1_INP2, COMP2_INN2, SEG25
								SPI2_MISO/I ² S2_MCK	
								USART3_TX	
								USART3_RX	
11	11	-	-	-	-	-	PC3	I/O	COM
								EVENTOUT	ADC_IN13, COMP1_INP3, COMP2_INN3, SEG24
								SPI2_MOSI/I ² S2_SD	
								USART3_RX	
								USART3_TX	
12	12	8	8	4	4		V _{SSA}	G	
13	13	9	9	5	5				
14	14	10	10	6	-	PA0	I/O	COM	USART2_CTS TIM2_CH1_ETR USART4_TX COMP1_OUT SPI2_SCK/I ² S2_CK
15	15	11	11	7	-	PA1	I/O	COM	EVENTOUT USART2_RTS TIM2_CH2 USART4_RX

封装							端口功能			
16	16	12	12	8	6	PA2	I/O	COM	TIM15_CH1N	COMP2_INN5, SEG22
									I ² C1_SMBA	
									SPI1_SCK/I ² S1_CK	
									SPI2_MOSI/I ² S2_SD	
									TIM15_CH1	ADC_IN2, COMP1_INP6, COMP1_INN2, COMP2_INP2, SEG21
									USART2_TX	
17	17	13	13	9	7	PA3	I/O	COM	TIM2_CH3	
									COMP2_OUT	
									SPI1_MOSI/I ² S1_SD	
									SPI2_MISO/I ² S2_MCK	
									SPI2_NSS/I ² S2_WS	
									EVENTOUT	ADC_IN3, COMP1_INP7, COMP1_INN3, COMP2_INP3, SEG20
18	18	-	-	-	-	PF3	I/O	COM	TIM15_CH2	
									USART2_RX	
									TIM2_CH4	
									SPI2_MISO/I ² S2_MCK	
									SPI2_NSS/I ² S2_WS	
									EVENTOUT	
19	19	-	-	-	-	PF4	I/O	COM	I ² C1_SCL	-
									I ² C2_SCL	
									I ² C1_SDA	
									I ² C2_SDA	
									EVENTOUT	ADC_IN4, DAC1_OUT, COMP1_INP8, COMP1_INN4,
									SPI1_NSS/I ² S1_WS	
20	20	14	14	10	8	PA4	I/O	COM	USART2_CK	
									TIM14_CH1	

封装							端口功能						
21	21	15	15	11	9	PA5	I/O	COM	SPI2_MOSI/I ² S2_SD	COMP2_INP4, SEG19			
									USART2_TX				
									PVD_OUT				
22	22	16	16	12	10	PA6	I/O	COM	EVENTOUT	ADC_IN5, DAC2_OUT, COMP1_INP9, COMP1_INN5, COMP2_INP5, COMP3_INP0, COMP3_INN0, SEG18, OPA2_OUT			
									SPI1_SCK/I ² S1_CK				
									TIM2_CH1_ETR				
									USART3_TX				
									EVENTOUT				
									SPI1_MISO/I ² S1_MCK				
									TIM3_CH1				
23	23	17	17	13	11	PA7	I/O	COM	TIM1_BKIN	ADC_IN6, COMP1_INP10, COMP1_INN6, OPA2_INN, SEG17			
									USART3_CTS				
									TIM16_CH1				
									COMP1_OUT				
									EVENTOUT				
									SPI1_MOSI/I ² S1_SD				
									TIM3_CH2				
24	24	18	18	14	12	PA8	I/O	COM	TIM1_CH1N	ADC_IN7, COMP1_INP11, COMP1_INN7, OPA2_INP, SEG16			
									TIM14_CH1				
									TIM17_CH1				
									COMP2_OUT				
									EVENTOUT				

封装							端口功能			
24	24	PC4						EVENTOUT USART3_TX COMP3_OUT SPI1_NSS/I ² S1_WS USART1_TX TIM2_CH1_ETR IR_OUT	ADC_IN14, COMP1_INN8, SEG15	
25	25	PC5						USART3_RX SPI1_MOSI/I ² S1_SD USART1_RX TIM2_CH2	ADC_IN15, COMP1_INN9, SEG14	
26	26	PB0						EVENTOUT TIM3_CH3 TIM1_CH2N USART3_CK COMP1_OUT SPI1_NSS/I ² S1_WS USART3_RX	ADC_IN8, COMP2_INN6, SEG13	
27	27	PB1						EVENTOUT TIM14_CH1 TIM3_CH4 TIM1_CH3N USART3_RTS COMP3_OUT	ADC_IN9, COMP2_INP6, COMP2_INN7, COMP3_INP1, COMP3_INN1, SEG12	
28	28	20	20	-	-	PB2	I/O	COM	EVENTOUT	COMP2_INP7,

封装							端口功能			
29	29	21	21	-	-	PB10	I/O	COM	SPI2_MISO/I ² S2_MCK	COMP2_INN8, SEG11
									USART3_TX	
30	30	22	22	-	-	PB11	I/O	COM	I ² C2_SCL	COMP2_INP8, SEG10
									TIM2_CH3	
									USART3_TX	
									SPI2_SCK/I ² S2_CK	
									COMP1_OUT	
									USART2_RTS	
									I ² C1_SCL	
									EVENTOUT	COMP3_INP2, COMP3_INN2, SEG9
									I ² C2_SDA	
31	31	23	23	16	-	V _{ss}	I/O	COM	TIM2_CH4	
									USART3_RX	
									COMP2_OUT	
									SPI2_MOSI/I ² S2_SD	
									USART2_CTS	
									I ² C1_SDA	
									EVENTOUT	COMP2_INN15, OPA3_INN, SEG8
									SPI2_NSS/I ² S2_WS	
									TIM1_BKIN	
32	33	25	25	-	-	PB12	I/O	COM	USART3_CK	
									TIM15_BKIN	
									EVENTOUT	COMP2_INP10,
									COMP2_INN15,	
									OPA3_INN,	
34	34	26	26	-	-	PB13	I/O	COM	SEG8	
									SEG8	

封装							端口功能						
35	35	27	27	-	-	PB14	I/O	COM	SPI2_SCK/I ² S2_CK	OPA3_INP, SEG7			
									TIM1_CH1N				
									USART3_CTS				
									I ² C2_SCL				
									MCO				
									TIM15_CH1N				
									I ² C1_SCL				
36	36	28	28	-	-	PB15	I/O	COM	EVENTOUT	COMP2_INP11, COMP3_INP3, COMP3_INN3, OPA3_OUT, SEG6			
									SPI2_MISO/I ² S2_MCK				
									TIM15_CH1				
									TIM1_CH2N				
									USART3_RTS				
									I ² C2_SDA				
									I ² C1_SDA				
37	37	-	-	-	-	PC6	I/O	COM	EVENTOUT	SEG5			
									SPI2_MOSI/I ² S2_SD				
									TIM15_CH2				
									TIM1_CH3N				
									TIM15_CH1N				
38	38	-	-	-	-	PC7	I/O	COM	TIM3_CH1	SEG4			
									SPI2_SCK/I ² S2_CK				
									USART4_RX				
									TIM2_CH3				
38	38	-	-	-	-	PC7	I/O	COM	TIM3_CH2	COMP3_INN4, SEG3			
									SPI2_MISO/I ² S2_MCK				

封装							端口功能						
39	39	-	-	-	-	-	PC8	I/O	COM	USART4_TX	SEG2	TIM2_CH4	
										TIM3_CH3			
										SPI2_MOSI/I ² S2_SD			
										USART4_CTS			
										TIM1_CH1			
40	40	-	-	-	-	-	PC9	I/O	COM	TIM3_CH4	SEG1	SPI2_NSS/I ² S2_WS	
										SPI1_SCK/I ² S1_CK			
										USART4_RTS			
										TIM1_CH2			
										EVENTOUT			
41	41	29	29	18	-		PA8	I/O	COM	MCO	COM0, OPA1_OUT	USART1_CK	
										TIM1_CH1			
										CTC_SYNC			
										SPI2_NSS			
										USART1_TX			
42	42	30	30	19	14			I/O	COM	EVENTOUT	COM1, OPA1_INP	TIM15_BKIN	
										USART1_RX			
										TIM1_CH2			
										I ² C1_SCL			
										SPI2_MISO/I ² S2_MCK			
										MCO			

封装							端口功能		
							I ² C2_SCL		
43	43	31	31	20	15	PA10	I/O	COM	EVENTOUT
									TIM17_BKIN
									USART1_RX
									TIM1_CH3
									I ² C1_SDA
									SPI2_MOSI/I ² S2_SD
									I ² C2_SDA
44	44	32	32	21	16	PA11	I/O	COM_U	EVENTOUT
									USART1_CTS
									TIM1_CH4
									COMP1_OUT
									SPI1_MISO/I ² S1_MCK
									TIM1_BKIN2
45	45	33	33	22	17	PA12	I/O	COM_U	EVENTOUT
									USART1_RTS
									TIM1_ETR
									COMP2_OUT
									SPI1_MOSI/I ² S1_SD
									SPI1_SCK/I ² S1_CK
46	46	34	34	23	18	PA13-SWD	I/O	COM	EVENTOUT
									SWDIO
									IR_OUT
									USART1_RX
									COMP3_OUT

封装							端口功能		
							PVD_OUT		
47	47	35	35	24	-	PF5	I/O	COM	TIM1_BKIN2 RTC_OUT, COM3
48	48	36	36	-	-	PF6	I/O	COM	USART1_CTS -
49	49	37	37	25	19	PA14-SWC	I/O	COM	EVENTOUT SWCLK USART2_TX USART1_TX PVD_OUT
50	50	38	38	-	-	PA15	I/O	COM	EVENTOUT SPI1_NSS/I ² S1_WS USART2_RX TIM2_CH1_ETR USART4_RTS USART3_RTS
51	51	-	-	-	-	PC10	I/O	COM	USART4_TX USART3_TX TIM1_CH3
52	52	-	-	-	-	PC11	I/O	COM	USART4_RX USART3_RX TIM1_CH4
53	53	-	-	-	-	PC12	I/O	COM	USART4_CK USART3_CK TIM14_CH1
54	54	-	-	-	-	PF7	I/O	COM	TIM3_ETR COM7/SEG36

封装							端口功能				
55	55	39	39	-	-	PB3	I/O	COM	USART3_RTS	COMP2_INN9, SEG35/VLCDH	
									TIM1_CH1N		
									EVENTOUT		
									SPI1_SCK/I ² S1_CK		
									TIM2_CH2		
									USART1_RTS		
56	56	40	40	26	-	PB4	I/O	COM	TIM1_CH2	COMP1_INP12, COMP2_INP12, SEG34/VLCD3	
									EVENTOUT		
									SPI1_MISO/I ² S1_MCK		
									TIM3_CH1		
									USART1_CTS		
									USART1_CK		
									TIM1_CH2N		
57	57	41	41	27	-	PB5	I/O	COM	TIM17_BKIN	COMP1_INP13, SEG33/VLCD2	
									SPI1_MOSI/I ² S1_SD		
									TIM3_CH2		
									TIM16_BKIN		
									I ² C1_SMBA		
									USART1_CK		
									COMP2_OUT		
									USART1_RTS		
									USART1_TX		
									TIM1_CH3N		
58	58	42	42	28	20	PB6	I/O	COM	EVENTOUT	COMP1_INP14, COMP2_INP14,	
									USART1_TX		

封装							端口功能				
59	59	43	43	29	21	PB7	I/O	COM	SEG32/VLCD1		
							I ² C1_SCL		SEG31 PVD_IN, COMP2_INP15, SEG31		
							TIM16_CH1N				
							SPI2_MISO/I ² S2_MCK				
							USART3_CTS				
							TIM1_CH3				
							I ² C2_SCL				
							EVENTOUT				
							USART1_RX				
							I ² C1_SDA				
60	60	44	44	30	22	PF8/BOOT	I/O	COM	(3)		
							EVENTOUT		SEG29		
							I ² C1_SCL				
							I ² C2_SCL				
							TIM16_CH1				
61	61	45	45	31	23	PB8	I/O	COM	SPI2_SCK/I ² S2_CK	SEG29	
							USART1_TX				
							USART3_TX				
							TIM15_BKIN				
							TIM1_CH1N				
62	62	46	46	32	24	PB9	I/O	COM	-	EVENTOUT	SEG28

封装							端口功能			
63	63	47	47	-	-	V _{ss}	G	-	-	Ground
64	64	48	48	-	-	V _{cc}	S	-	-	Digital power supply

1. 选择 PF2 或者 NRST 通过 option bytes 进行配置。
2. 复位后, PA13 和 PA14 两个 pin 被配置为 SWDIO 和 SWCLK AF 功能, 前者内部上拉电阻、后者内部下拉电阻被激活。
3. PF8-BOOT0 默认数字输入模式, 且下拉使能。

3.1. 端口 A 复用功能映射

表 3-3 端口 A 复用功能映射

PortA	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
PA0	-	USART2_CTS	TIM2_CH1_ETR	-	USART4_TX	-	-	COMP1_OUT	SPI2_SCK	-	-	-	-	-	-	-
PA1	EVENTOUT	USART2 RTS	TIM2_CH2	-	USART4_RX	TIM15_CH1_N	I ² C1_SMBA	-	SPI1_SCK/I ² S1_CK	SPI2_MOSI	-	-	-	-	-	-
PA2	TIM15_CH1	USART2_TX	TIM2_CH3	-	-	-	-	COM2_OUT	SPI1_MOSI/I ² S1_SD	SPI2_MISO	-	-	-	-	-	-
PA3	TIM15_CH2	USART2_RX	TIM2_CH4	-	-	-	-	EVENTOUT	SPI2_MISO	SPI2 NSS/I ² S2_WS	-	-	-	-	-	-
PA4	SPI1 NSS/I ² S1 WS	USART2 CK	-	-	TIM14_CH1	-	-	EVENTOUT	SPI2_MOSI	USART2_TX	-	-	PVD_OUT	-	-	-
PA5	SPI1_SCK/I ² S1_CK	-	TIM2_CH1_ETR	-	-	-	-	EVENTOUT	-	-	USART3_TX	-	-	-	-	-
PA6	SPI1_MISO/I ² S1_MCK	TIM3_CH1	TIM1_BKIN	-	USART3_CTS	TIM16_CH1	EVENTOUT	COMP1_OUT	-	-	-	-	-	-	-	-
PA7	SPI1_MOSI/I ² S1_SD	TIM3_CH2	TIM1_CH1N	-	TIM14_CH1	TIM17_CH1	EVENTOUT	COMP2_OUT	-	-	-	-	-	-	-	-
PA8	MCO	USART1 CK	TIM1_CH1	EVENTOUT	CTC_SYNC	-	-	SPI2 NSS	-	USART1_TX	-	-	-	-	-	-
PA9	TIM15_BKIN	USART1 TX	TIM1_CH2	-	-	-	I ² C1_SCL	EVENTOUT	SPI2_MISO	MCO	-	-	-	I ² C2_SCL	-	-
PA10	TIM17_BKIN	USART1_RX	TIM1_CH3	-	-	-	I ² C1_SDA	EVENTOUT	SPI2_MOSI	-	-	-	-	I ² C2_SD_A	-	-
PA11	EVENTOUT	USART1_CTS	TIM1_CH4	-	-	-	-	COMP1_OUT	SPI1_MISO/I ² S1_MCK	-	-	TIM1_BKIN2	-	-	-	-
PA12	EVENTOUT	USART1 RTS	TIM1_ETR	-	-	-	-	COMP2_OUT	SPI1_MOSI/I ² S1_SD	SPI1_SCK/I ² S1_CK	-	-	-	-	-	-
PA13	SWDIO	IROUT	-	-	-	-	-	EVENTOUT	-	USART1_RX	-	COMP3_OUT	PVD_OUT	-	-	-
PA14	SWCLK	USART2 TX	-	-	-	-	-	EVENTOUT	-	USART1_TX	-	-	PVD_OUT	-	-	-
PA15	SPI1 NSS/I ² S1 WS	USART2_RX	TIM2_CH1_ETR	EVENTOUT	USART4 RTS	-	-	EVENTOUT	-	-	USART3 RTS	-	-	-	-	-

3.2. 端口 B 复用功能映射

表 3-4 端口 B 复用功能映射

PortB	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
PB0	EVENTOUT	TIM3_CH3	TIM1_CH2N	-	USART3_CK	-	-	COMP1_OUT	SPI1_NSS/ I ² S1_WS	-	USART3_RX	-	-	-	-	-
PB1	TIM14_CH1	TIM3_CH4	TIM1_CH3N	-	USART3_RTS	-	-	EVENTOUT	-	-	-	COMP3_OUT	-	-	-	-
PB2	-	-	-	-	-	-	-	EVENTOUT	SPI2_MISO	-	USART3_TX	-	-	-	-	-
PB3	SPI1_SCK/ I ² S1_CK	EVENTOUT	TIM2_CH2	-	USART1_RTS	-	-	EVENTOUT	-	-	-	TIM1_CH2	-	-	-	-
PB4	SPI1_MISO/ I ² S1_MCK	TIM3_CH1	EVENTOUT	-	USART1_CTS	TIM17_BKIN	-	-	-	-	-	TIM1_CH2N	-	USART1_CK	-	-
PB5	SPI1_MOSI/ I ² S1_SD	Tim3_CH2	TIM16_BKIN	I ² C1_SMBA	USART1_CK	-	-	COM2_OUT	-	USART1_RTS	-	TIM1_CH3N	-	USART1_TX	-	-
PB6	USART1_TX	I ² C1_SCL	TIM16_CH1N	-	-	-	-	EVENTOUT	SPI2_MISO	-	USART3_CTS	TIM1_CH3	-	I ² C2_SCL	-	-
PB7	USART1_RX	I ² C1_SDA	TIM17_CH1N	-	USART4_CTS	-	-	EVENTOUT	SPI2_MOSI	-	-	TIM1_CH1	-	I ² C2_SDA	-	-
PB8	-	I ² C1_SCL	TIM16_CH1	-	-	-	-	EVENTOUT	SPI2_SCK	USART1_TX	USART3_TX	TIM15_BKIN	-	I ² C2_SCL	TIM1_CH1N	-
PB9	IR_OUT	I ² C1_SDA	TIM17_CH1	EVENTOUT	-	SPI2_NSS/ I ² S2_WS	-	-	-	USART1_RX	USART3_RX	-	-	I ² C2_SDA	-	-
PB10	-	I ² C2_SCL	TIM2_CH3	-	USART3_TX	SPI2_SCK/ I ² S2_CK	-	COMP1_OUT	-	USART2_RTS	-	-	-	I ² C1_SCL	-	-
PB11	EVENTOUT	I ² C2_SDA	TIM2_CH4	-	USART3_RX	-	-	COMP2_OUT	SPI2_MOSI	USART2_CTS	-	-	-	I ² C1_SDA	-	-
PB12	SPI2_NSS/ I ² S2_WS	EVENTOUT	TIM1_BKIN	-	USART3_CK	TIM15_BKIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PB13	SPI2_SCK/ I ² S2_CK	-	TIM1_CH1N	-	USART3_CTS	I ² C2_SCL	-	EVENTOUT	-	MCO	-	TIM15_CH1N	-	I ² C1_SCL	-	-
PB14	SPI2_MISO/ I ² S2_MCK	TIM15_CH1	TIM1_CH2N	-	USART3_RTS	I ² C2_SDA	-	EVENTOUT	-	-	-	-	-	I ² C1_SDA	-	-
PB15	SPI2_MOSI/ I ² S2_SD	TIM15_CH2	TIM1_CH3N	TIM15_CH1N	-	-	-	EVENTOUT	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. 端口 C 复用功能映射

表 3-5 端口 C 复用功能映射

PortC	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
PC0	EVENTOUT	-	-	-	-	-	-	-	SPI1_MISO/I ² S1_MCK	USART2_CTS	USART3_RTS	-	-	-	-	-
PC1	EVENTOUT	-	-	-	-	-	-	-	SPI1_MOSI/I ² S1_SD	USART2_RTS	USART3_CTS	TIM15_CH1	-	-	-	-
PC2	EVENTOUT	SPI2_MISO/I ² S2_MCK	-	-	-	-	-	-	-	USART3_TX	USART3_RX	TIM15_CH2	-	-	-	-
PC3	EVENTOUT	SPI2_MOSI/I ² S2_SD	-	-	-	-	-	-	-	USART3_RX	USART3_TX	-	-	-	-	-
PC4	EVENTOUT	USART3_TX	-	-	-	-	-	COMP3_OUT	SPI1_NSS/I ² S1_WS	USART1_TX	-	TIM2_CH1_ETR	IR_OUT	-	-	-
PC5	-	USART3_RX	-	-	-	-	-	-	SPI1_MOSI/I ² S1_SD	USART1_RX	-	TM2_CH2	-	-	-	-
PC6	TIM3_CH1	-	-	-	-	-	-	-	SPI2_SCK/I ² S2_CK	-	USART4_RX	TIM2_CH3	-	-	-	-
PC7	TIM3_CH2	-	-	-	-	-	-	-	SPI2_MISO/I ² S2_MCK	-	USART4_TX	TIM2_CH4	-	-	-	-
PC8	TIM3_CH3	-	-	-	-	-	-	-	SPI2_MOSI/I ² S2_SD	-	USART4_CTS	TIM1_CH1	-	-	-	-
PC9	TIM3_CH4	-	-	-	-	-	-	-	SPI2_NSS/I ² S2_WS	SPI1_SCK/I ² S1_CK	USART4_RTS	TIM1_CH2	-	-	-	-
PC10	USART4_TX	USART3_TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TIM1_CH3	-	-	-	-
PC11	USART4_RX	USART3_RX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TIM1_CH4	-	-	-	-
PC12	USART4_CK	USART3_CK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TIM14_CH1	-	-	-	-
PC13	-	-	-	-	-	-	-	-	SPI1_SCK/I ² S1_CK	-	-	TIM1_BKIN	-	-	-	-
PC14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TIM1_BKIN2	-	-	-	-
PC15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TIM15_BKIN	-	-	-	-

3.4. 端口 F 复用功能映射

表 3-6 端口 F 复用功能映射

PortF	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
PF0	CTC_SYNC	-	-	-	-	-	-	-	-	USART2_TX	-	TIM14_CH1	-	TIM1_BKIN	-	-
PF1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USART2_RX	-	TIM15_CH1N	-	TIM1_CH1N	-	-
PF2	EVENTOUT	-	-	-	-	-	-	-	MCO	-	-	-	-	TIM1_CH2	-	-
PF3	EVENTOUT	-	-	-	-	-	I ² C1_SCL	-	-	-	-	-	-	I ² C2_SCL	-	-
PF4	-	-	-	-	-	-	I ² C1_SDA	-	-	-	-	-	-	I ² C2_SDA	-	-
PF5	-	-	TIM1_BKIN2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF6	-	-	-	-	USART1_CTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF7	TIM3_ETR	USART3 RTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TIM1_CH1N	-	-	-	-
PF8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PF9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 存储器映射

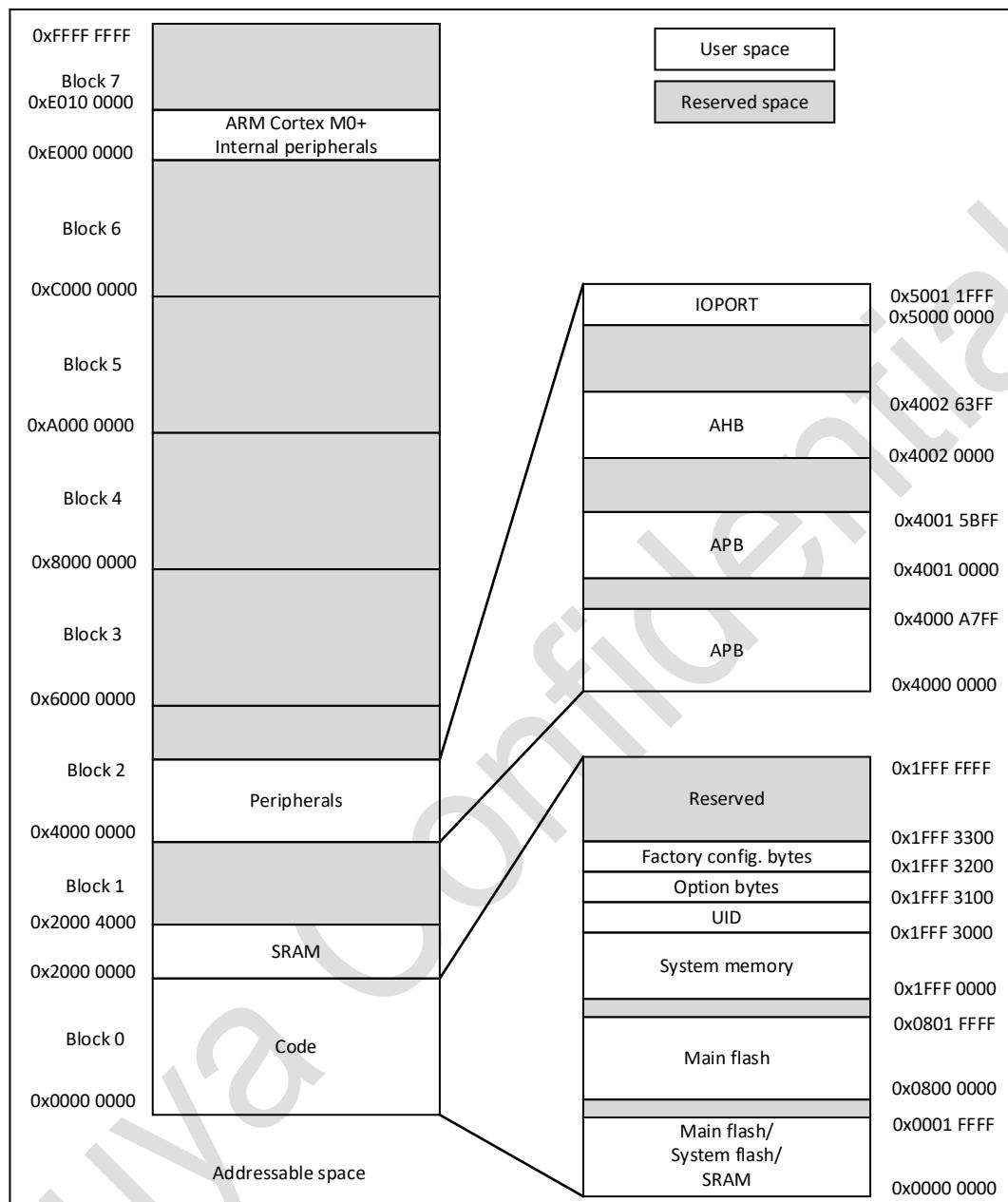


图 4-1 存储器映射

表 4-1 存储器地址

Type	Boundary address	Size	Memory area	Description
SRAM	0x2000 4000-0x3FFF FFFF	-	保留 ⁽¹⁾	-
	0x2000 0000-0x2000 3FFF	16 KB	SRAM	SRAM 最大为 16 KB
Code	0x1FFF 3300-0x1FFF FFFF	-	保留	-
	0x1FFF 3200-0x1FFF 32FF	256 bytes	FT info0 bytes	Factory config.bytes
	0x1FFF 3100-0x1FFF 31FF	256 bytes	Option bytes	芯片软硬件选项字节信息
	0x1FFF 3000-0x1FFF 30FF	256 bytes	UID bytes	Unique ID
	0x1FFF 0000-0x1FFF 2FFF	12 KB	System memory	存放 boot loader
	0x0802 0000-0x1FFE FFFF	-	保留	-
	0x0800 0000-0x0801 FFFF	128 KB	Main flash memory	-
	0x0002 0000-0x07FF FFFF	-	保留	-
	0x0000 0000-0x0001 FFFF	128 KB	根据 Boot 配置选择: 1) Main flash memory 2) System memory 3) SRAM	-

1. 上述标注为**保留**的空间，无法进行写操作，读为 0，且产生 response error。

表 4-2 外设寄存器地址⁽¹⁾

Bus	Boundary address	Size	Peripherals
-	0xE000 000 - 0xE00F FFFF	-	M0+
IOPORT	0x5000 1800 - 0x5FFF FFFF	-	保留
	0x5000 1400 - 0x5000 17FF	1 KB	GPIOF
	0x5000 0C00 - 0x5000 13FF	-	保留
	0x5000 0800 - 0x5000 0BFF	1 KB	GPIOC
	0x5000 0400 - 0x5000 07FF	1 KB	GPIOB
	0x5000 0000 - 0x5000 03FF	1 KB	GPIOA
AHB	0x4002 3C00 - 0x4FFF FFFF	-	保留
	0x4002 3800 - 0x4002 3BFF	1 KB	DIV
	0x4002 3400 - 0x4002 37FF	-	保留
	0x4002 3000 - 0x4002 33FF	1 KB	CRC
	0x4002 2400 - 0x4002 2FFF	-	保留
	0x4002 2000 - 0x4002 23FF	1 KB	Flash
	0x4002 1C00 - 0x4002 1FFF	-	保留
	0x4002 1800 - 0x4002 1BFF	1 KB	EXTI
	0x4002 1400 - 0x4002 17FF	-	保留
	0x4002 1000 - 0x4002 13FF	1 KB	RCC ⁽²⁾
	0x4002 0400 - 0x4002 0FFF	-	保留
	0x4002 0000 - 0x4002 03FF	1 KB	DMA
APB	0x4001 5C00 - 0x4001 FFFF	-	保留

Bus	Boundary address	Size	Peripherals
	0x4001 5800 - 0x4001 5BFF	1 KB	DBG
	0x4001 4C00 - 0x4001 57FF	-	保留
	0x4001 4800 - 0x4001 4BFF	1 KB	TIM17
	0x4001 4400 - 0x4001 47FF	1 KB	TIM16
	0x4001 4000 - 0x4001 43FF	1 KB	TIM15
	0x4001 3C00 - 0x4001 3FFF	-	保留
	0x4001 3800 - 0x4001 3BFF	1 KB	USART1
	0x4001 3400 - 0x4001 37FF	-	保留
	0x4001 3000 - 0x4001 33FF	1 KB	SPI1/I ² S1
	0x4001 2C00 - 0x4001 2FFF	1 KB	TIM1
	0x4001 2800 - 0x4001 2BFF	-	保留
	0x4001 2400 - 0x4001 27FF	1 KB	ADC
	0x4001 0400 - 0x4001 23FF	-	保留
	0x4001 0300 - 0x4001 03FF	1 KB	OPA
	0x4001 0200 - 0x4001 02FF		COMP
	0x4001 0000 - 0x4001 01FF		SYSCFG
	0x4000 8000- 0x4000 FFFF	-	保留
	0x4000 7C00 - 0x4000 7FFF	1 KB	LPTIM1
	0x4000 7800 - 0x4000 7BFF	-	保留
	0x4000 7400 - 0x4000 77FF	1 KB	DAC
	0x4000 7000 - 0x4000 73FF	1 KB	PWR ⁽³⁾
	0x4000 6C00 - 0x4000 6FFF	1 KB	CTC
	0x4000 6400 - 0x4000 6BFF	-	保留
	0x4000 6000 - 0x4000 63FF	1 KB	USB SRAM
	0x4000 5C00 - 0x4000 5FFF	1 KB	USB
	0x4000 5800 - 0x4000 5BFF	1 KB	I ² C2
	0x4000 5400 - 0x4000 57FF	1 KB	I ² C1
	0x4000 5000 - 0x4000 53FF	-	保留
	0x4000 4C00 - 0x4000 4FFF	1 KB	USART4
	0x4000 4800 - 0x4000 4BFF	1 KB	USART3
	0x4000 4400 - 0x4000 47FF	1 KB	USART2
	0x4000 3C00 - 0x4000 43FF	-	保留
	0x4000 3800 - 0x4000 3BFF	1 KB	SPI2/I ² S2
	0x4000 3400 - 0x4000 37FF	-	保留
	0x4000 3000 - 0x4000 33FF	1 KB	IWDG
	0x4000 2C00 - 0x4000 2FFF	1 KB	WWDG
	0x4000 2800 - 0x4000 2BFF	1 KB	RTC
	0x4000 2400 - 0x4000 27FF	1 KB	LCD
	0x4000 2000 - 0x4000 23FF	1 KB	TIM14

Bus	Boundary address	Size	Peripherals
	0x4000 1800 - 0x4000 1FFF	-	保留
	0x4000 1400 - 0x4000 17FF	1 KB	TIM7
	0x4000 1000 - 0x4000 13FF	1 KB	TIM6
	0x4000 0800 - 0x4000 0FFF	-	保留
	0x4000 0400 - 0x4000 07FF	1 KB	TIM3
	0x4000 0000 - 0x4000 03FF	1 KB	TIM2

1. 上表 AHB 标注为**保留**的地址空间，无法写操作，读回为 0，且产生 HardFault。
2. 不仅支持 32 位字访问，还支持半字和字节访问。
3. 不仅支持 32 位字访问，还支持半字访问。

5. 电气特性

5.1. 测试条件

除非特殊说明，所有的电压都以 V_{SS} 为基准。

5.1.1. 最小值和最大值

除非特殊说明，通过在环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 和 $T_A=T_{A(\text{max})}$ 下进行的芯片量产测试筛选，保证在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件下达到最小值和最大值。

基于表格下方注解的电特性结果、设计仿真和/或工艺参数的数据，未在生产中进行测试。最小和最大数值参考了样品测试，取平均值再加或者减三倍的标准偏差。

5.1.2. 典型值

除非特殊说明，典型数据是基于 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 和 $V_{CC}=3.3\text{ V}$ 。这些数据仅用于设计指导未经过测试。

典型的 ADC 精度数值是通过对一个标准批次的采样，在所有温度范围下测试得到，95 % 的芯片误差小于等于给出的数值。

5.1.3. 供电方案

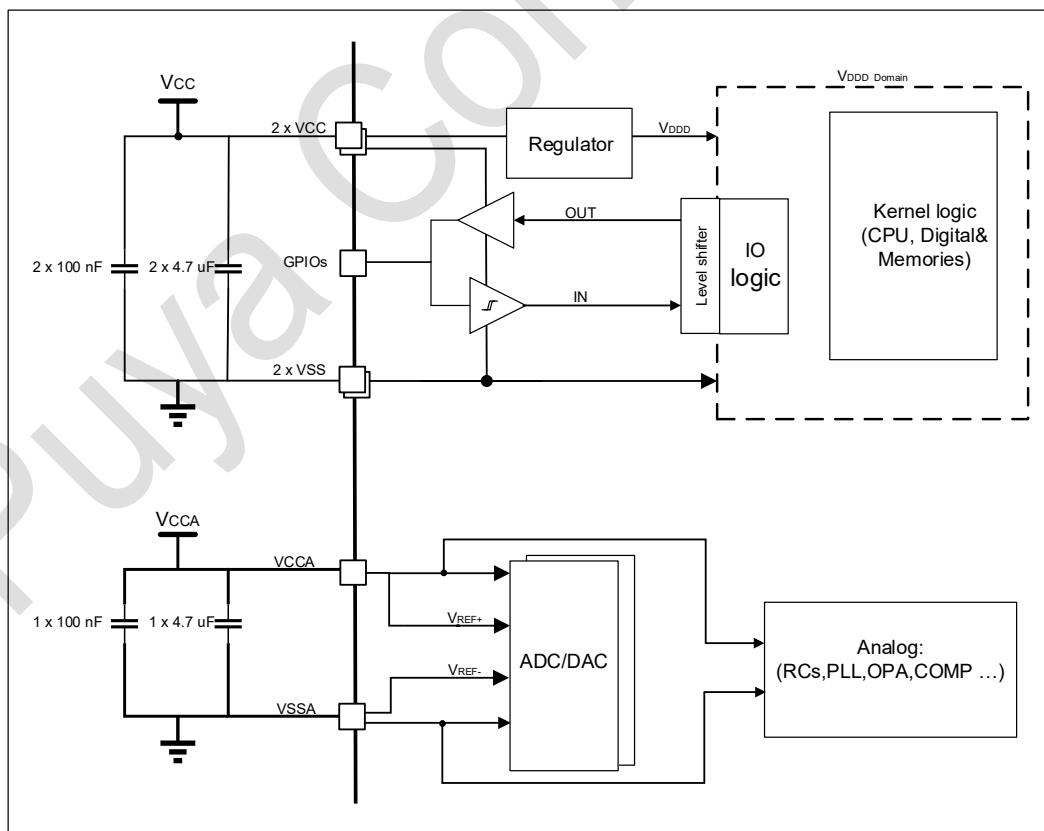


图 5-1 供电方案图

5.2. 绝对最大额定值

如果加在芯片上超过以下表格给出的绝对最大值，可能会导致芯片永久性的损坏。这里只是列出了所能承受的强度分等，并不意味着在此条件下器件的功能操作无误。长时间工作在最大值条件下可能影响芯片的可靠性。

表 5-1 电压特性⁽¹⁾

符号	描述	最小值	最大值	单位
$V_{CC}-V_{SS}$	外部主供电电源	- 0.3	6.25	V
V_{IN}	其他引脚的输入电压	- 0.3	$V_{CC} + 0.3$	V

1. 电源 V_{CC} 和地 V_{SS} 引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。

表 5-2 电流特性

符号	描述	最大值	单位
ΣI_{VCC}	流进 V_{CC} 引脚的总电流(供应电流) ⁽¹⁾	170	mA
ΣI_{VSS}	流出 V_{SS} 引脚的总电流(流出电流) ⁽¹⁾	170	mA
$I_{IO(PIN)}$ ⁽²⁾	任意 I/O 和控制引脚的输出灌电流	20	mA
	任意 I/O 和控制引脚的输出拉电流	20	
$\Sigma I_{IO(PIN)}$ ⁽²⁾	所有 I/O 和控制引脚的总输出灌电流	150	mA
	所有 I/O 和控制引脚的总拉电流	150	

1. 电源 V_{CC} 和地 V_{SS} 引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。
2. IO 类型可参考引脚定义的术语和符号。

表 5-3 温度特性

符号	描述	条件	数值	单位
T_{STG}	存储温度范围	-	- 65 ~ + 150	°C
T_O	工作温度范围	x6 版本	- 40 ~ + 85	°C
		X7 版本	- 40 ~ + 105	

5.3. 工作条件

5.3.1. 通用工作条件

表 5-4 通用工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
f_{HCLK}	内部 AHB 时钟频率	-	0	72	MHz
f_{PCLK}	内部 APB 时钟频率	-	0	72	MHz
V_{CC}	标准工作电压	-	1.7	5.5	V
V_{CCA}	模拟电路工作电压	必须与 V_{CC} 相同	1.7	5.5	V
V_{IN}	IO 输入电压	-	- 0.3	$V_{CC} + 0.3$	V
T_A	环境温度	x6 版本	- 40	85	°C
		X7 版本	- 40	105	

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
T_J	结温	x6 版本	-40	90	°C
		X7 版本	-40	110	

5.3.2. 上下电工作条件

表 5-5 上电和掉电工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
t_{VCC}	V_{CC} 上升速率	-	10	∞	$\mu s/V$
	V_{CC} 下降速率	-	20	∞	

5.3.3. 内嵌复位和 PVD 模块特性

表 5-6 POR/POR/BOR 模块特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$t_{RSTTEMPO}^{(1)}$	复位重置时间	-	-	4.0	7.5	ms
$V_{POR/PDR}$	上电/下电复位阈值	上升沿	1.5	1.6	1.7	V
		下降沿	1.45	1.55	1.65	
$V_{PDRhyst}^{(1)}$	PDR 迟滞	-	-	50	-	mV
V_{BOR}	BOR 阈值电压	BORLEV[2:0]=000 (上升沿)	1.7	1.8	1.9	V
		BORLEV[2:0]=000 (下降沿)	1.6	1.7	1.8	
		BORLEV[2:0]=001 (上升沿)	1.9	2	2.1	
		BORLEV[2:0]=001 (下降沿)	1.8	1.9	2	
		BORLEV[2:0]=010 (上升沿)	2.1	2.2	2.3	
		BORLEV[2:0]=010 (下降沿)	2	2.1	2.2	
		BORLEV[2:0]=011 (上升沿)	2.3	2.4	2.5	
		BORLEV[2:0]=011 (下降沿)	2.2	2.3	2.4	
		BORLEV[2:0]=100 (上升沿)	2.5	2.6	2.7	
		BORLEV[2:0]=100 (下降沿)	2.4	2.5	2.6	
		BORLEV[2:0]=101 (上升沿)	2.7	2.8	2.9	
		BORLEV[2:0]=101 (下降沿)	2.6	2.7	2.8	
		BORLEV[2:0]=110 (上升沿)	2.9	3	3.1	
		BORLEV[2:0]=110 (下降沿)	2.8	2.9	3	
		BORLEV[2:0]=111 (上升沿)	3.1	3.2	3.3	
		BORLEV[2:0]=111 (下降沿)	3	3.1	3.2	
$V_{BORhyst}$	BOR 迟滞	-	-	100	-	mV

1. 由设计保证, 不在生产中测试。

表 5-7 PVD 模块特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{PVD}^{(2)}$	可编程电压检测器 电平选择	PVDT[2:0]=000 (上升沿)	1.7	1.8	1.9	V
		PVDT[2:0]=000 (下降沿)	1.6	1.7	1.8	
		PVDT[2:0]=001 (上升沿)	1.9	2	2.1	

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
		PVDT[2:0]=001 (下降沿)	1.8	1.9	2	
		PVDT[2:0]=010 (上升沿)	2.1	2.2	2.3	
		PVDT[2:0]=010 (下降沿)	2	2.1	2.2	
		PVDT[2:0]=011 (上升沿)	2.3	2.4	2.5	
		PVDT[2:0]=011 (下降沿)	2.2	2.3	2.4	
		PVDT[2:0]=100 (上升沿)	2.5	2.6	2.7	
		PVDT[2:0]=100 (下降沿)	2.4	2.5	2.6	
		PVDT[2:0]=101 (上升沿)	2.7	2.8	2.9	
		PVDT[2:0]=101 (下降沿)	2.6	2.7	2.8	
		PVDT[2:0]=110 (上升沿)	2.9	3	3.1	
		PVDT[2:0]=110 (下降沿)	2.8	2.9	3	
		PVDT[2:0]=111 (上升沿)	3.1	3.2	3.3	
		PVDT[2:0]=111 (下降沿)	3	3.1	3.2	
$V_{PV\text{D}hyst}^{(1)}$	PVD 迟滞	-	-	100	-	mV

- 由设计保证, 不在生产中测试。
- 数据基于考核结果, 不在生产中测试。

5.3.4. 工作电流特性

表 5-8 运行模式电流

符号	条件						典型值 ⁽¹⁾	最大值		单位		
	系统时钟	频率	代码	运行	外设时钟	Flash sleep		$T_A=85^\circ\text{C}$	$T_A=105^\circ\text{C}$			
$I_{CC}(\text{Run})$	PLL*3 PLL*2	72 MHz	While(1)	Flash	ON	DISABLE	8.4	10.7	14.4	mA		
					OFF	DISABLE	4.6	5.3	6.3			
	HSI	48 MHz			ON	DISABLE	6.5	8.0	10.3			
					OFF	DISABLE	4.0	4.5	5.5			
		24 MHz			ON	DISABLE	3.8	4.3	5.3			
					OFF	DISABLE	2.6	2.8	3.8			
		16 MHz			ON	DISABLE	2.8	3.8	5.0			
					OFF	DISABLE	1.9	2.7	3.1			
	8 MHz	ON			ON	DISABLE	1.8	2.5	3.1			
					OFF	DISABLE	1.2	2.3	3.0			
		OFF			ON	DISABLE	1.0	2.3	3.0			
					OFF	DISABLE	0.9	1.3	3.0			
	4 MHz	ON			ON	DISABLE	0.4	0.6	1.1			
					OFF	DISABLE	0.3	0.5	0.9			
		OFF			ON	ENABLE	0.3	0.5	0.8			
					OFF	ENABLE	0.2	0.4	0.6			

- 数据基于考核结果, 不在生产中测试。

表 5-9 睡眠 (Sleep) 模式电流

符号	条件				典型值 ⁽¹⁾	最大值		单位
	系统时钟	频率	外设时钟	Flash sleep		T _A =85 °C	T _A =105 °C	
I _{CC} (Sleep)	PLL*3 PLL*2	72 MHz	ON	DISABLE	6.2	8.2	11.2	mA
			OFF	DISABLE	2.1	2.7	3.8	
		48 MHz	ON	DISABLE	4.6	6.1	7.4	
			OFF	DISABLE	1.8	2.3	3.0	
	HSI	24 MHz	ON	DISABLE	2.1	2.9	3.8	
			OFF	DISABLE	0.9	1.2	1.7	
		16 MHz	ON	DISABLE	1.6	2.3	3.0	
			OFF	DISABLE	0.7	1.0	1.5	
		8 MHz	ON	DISABLE	1.0	2.3	3.0	
			OFF	DISABLE	0.5	0.8	1.3	
		4 MHz	ON	DISABLE	0.7	1.1	1.7	
			OFF	DISABLE	0.5	0.7	1.2	
	LSI	32.768 kHz	ON	DISABLE	0.3	0.6	1.1	
			OFF	DISABLE	0.3	0.5	0.9	
		32.768 kHz	ON	ENABLE	0.3	0.6	0.9	
			OFF	ENABLE	0.2	0.4	0.7	

1. 数据基于考核结果, 不在生产中测试。

表 5-10 停机 (Stop) 模式电流

符号	条件					典型值 ⁽¹⁾	最大值		单位	
	V _{CC}	V _{DDX}	MR/LPR	LSI	外设时钟		T _A = 85 °C	T _A = 105 °C		
I _{CC} (Stop)	1.7 ~ 5.5 V	1.2 V	MR (LPR = 0)	-	-	130	356.7	519.1	μA	
				ON	RTC + IWDG + LPTIM	9.2	212.2	330.5		
					IWDG	9.3	212.1	330.6		
					LPTIM	9.3	211.8	330.0		
				OFF	RTC	9.2	211.8	330.2		
		1.0 V	LPR (LPR = 1)	ON	RTC + IWDG + LPTIM	7.2	162.1	254.1		
					IWDG	7.3	162.1	254.0		
					LPTIM	7.3	161.8	253.7		
					RTC	7.2	161.8	253.5		
		0.9V		OFF	-	7.0	161.8	253.6		
				ON	RTC + IWDG + LPTIM	6.2	124.9	196.0		
					IWDG	6.3	124.9	196.1		
					LPTIM	6.3	124.6	195.5		
		0.8 V			RTC	6.2	124.6	195.6		
		OFF		-	6.0	124.6	195.6			
		ON		RTC + IWDG + LPTIM	5.2	110.8	233.9			
				IWDG	5.3	112.5	248.1			

符号	条件					典型值 ⁽¹⁾	最大值		单位
	LPTIM		RTC		OFF		5.3	110.6	
					-		5.0	110.1	

1. 数据基于考核结果, 不在生产中测试。

5.3.5. 低功耗模式唤醒时间

表 5-11 低功耗模式唤醒时间

符号	参数 ⁽¹⁾		条件	典型值 ⁽²⁾	最大值	单位
$t_{WUSLEEP}$	睡眠模式唤醒时间		-	7	-	CPU cycles
t_{WUSTOP}	MR 供电 (LPR = 0)	MR 供电 (LPR = 0)	Flash 中执行程序, HSI(24 MHz)作为系统时钟	3	-	μs
		停机模式 唤醒时间	Flash 中执行程序, HSI(8 MHz)作为系统时钟	4.5	-	
	LPR 供电 (LPR = 1)	LPR 供电 (LPR = 1)	Flash 中执行程序, HSI(24 MHz)作为系统时钟	6	-	
		LPR 供电 (LPR = 1)	Flash 中执行程序, HSI(8 MHz)作为系统时钟	7	-	

1. 唤醒时间的测量是从唤醒时间开始至用户程序读取第一条指令。

2. 数据基于考核结果, 不在生产中测试。

5.3.6. 外部时钟源特性

5.3.6.1. 外部高速时钟

在 HSE 的 bypass 模式(RCC_CR 的 HSEBYP 置位), 芯片内的高速起振电路停止工作, 相应的 IO 作为标准的 GPIO 使用。

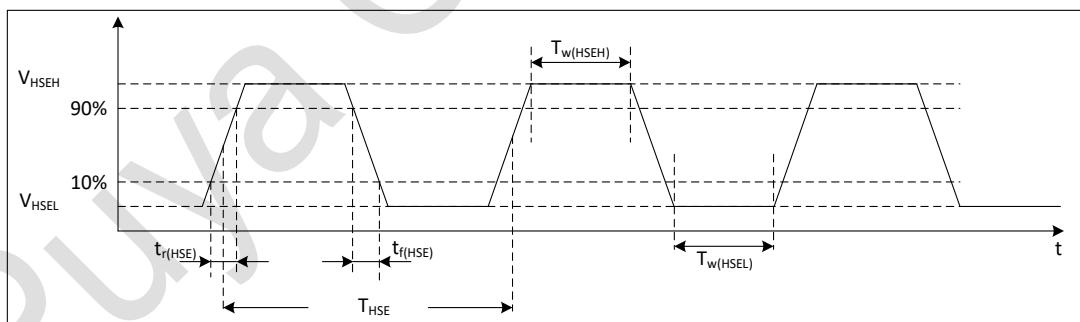


图 5-2 外部高速时钟时序图

表 5-12 外部高速时钟特性

符号	参数 ⁽¹⁾	最小值	典型值	最大值	单位
f_{HSE_ext}	用户外部时钟频率	1	8	32	MHz
V_{HSEH}	输入引脚高电平电压	0.7 V_{CC}	-	V_{CC}	V
V_{HSEL}	输入引脚低电平电压	V_{SS}	-	0.3 V_{CC}	
$t_{W(HSEH)}$ $t_{W(HSEL)}$	输入高或低的时间	15	-	-	ns

符号	参数 ⁽¹⁾	最小值	典型值	最大值	单位
$t_{r(HSE)}$ $t_{f(HSE)}$	输入上升/下降的时间	-	-	20	ns

1. 由设计保证, 不在生产中测试。

5.3.6.2. 外部低速时钟

在 LSE 的 bypass 模式(RCC_BDCR 的 LSEBYP 置位), 芯片内的低速起振电路停止工作, 相应的 IO 作为标准的 GPIO 使用。

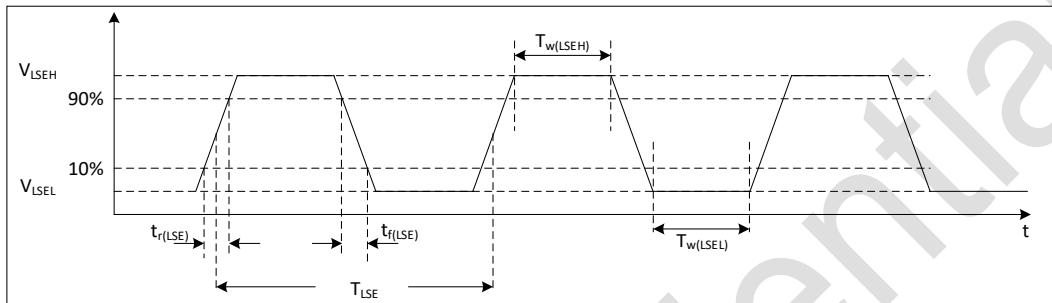


图 5-3 外部低速时钟时序图

表 5-13 外部低速时钟特性

符号	参数 ⁽¹⁾	最小值	典型值	最大值	单位
f_{LSE_ext}	用户外部时钟频率	-	32.768	1000	kHz
V_{LSEH}	输入引脚高电平电压	$0.7 V_{CC}$	-	-	V
V_{LSEL}	输入引脚低电平电压	-	-	$0.3 V_{CC}$	V
$t_{w(LSEH)}$ $t_{w(LSEL)}$	输入高或低的时间	450	-	-	ns
$t_{r(LSE)}$ $t_{f(LSE)}$	输入上升/下降的时间	-	-	50	ns

1. 由设计保证, 不在生产中测试。

5.3.6.3. 外部高速晶体

可以通过外接 4 ~ 32 MHz 的晶体/陶瓷谐振器。在应用中, 晶体和负载电容应该尽可能靠近管脚, 这样可以使输出变形和启动稳定时间最小化。

表 5-14 外部高速晶体特性

符号	参数	条件 ⁽¹⁾	最小值 ⁽²⁾	典型值	最大值 ⁽²⁾	单位
f_{OSC_IN}	振荡频率	-	4	-	32	MHz
$I_{CC}^{(4)}$	HSE 功耗	启动期间	-	-	5.5	mA
		$V_{CC}=3 V$, $R_m=80 \Omega$, $C_L=20 pF$ @ 8 MHz $HSE_DRV[1:0] = 01$	-	0.45	-	
		$V_{CC}=3 V$, $R_m=80 \Omega$, $C_L=20 pF$ @ 16 MHz $HSE_DRV[1:0] = 10$	-	1.00	-	

符号	参数	条件 ⁽¹⁾	最小值 ⁽²⁾	典型值	最大值 ⁽²⁾	单位
		$V_{CC}=3\text{ V}$, $R_m=30\text{ }\Omega$, $C_L=20\text{ pF}$ @ 24 MHz $HSE_DRV[1:0]=10$	-	1.10	-	
		$V_{CC}=3\text{ V}$, $R_m=30\text{ }\Omega$, $C_L=20\text{ pF}$ @ 24 MHz $HSE_DRV[1:0]=11$	-	1.40	-	
		$V_{CC}=3\text{ V}$, $R_m=35\text{ }\Omega$, $C_L=20\text{ pF}$ @ 32 MHz $HSE_DRV[1:0]=11$	-	1.50	-	
$t_{SU(HSE)}^{(3)(4)}$	启动时间	$f_{OSC_IN}=32\text{ MHz}$, $R_m=35\text{ }\Omega$, $C_L=20\text{ pF}$ @ 32 MHz $HSE_STARTUP[1:0]=00$ $HSE_DRV[1:0]=11$	-	2	-	ms
		$f_{OSC_IN}=4\text{ MHz}$, $R_m=100\text{ }\Omega$, $C_L=12\text{ pF}$ @ 4MHz $HSE_STARTUP[1:0]=00$ $HSE_DRV[1:0]=01$	-	1.8	-	

1. 晶体/陶瓷谐振器特性基于制造商给出的数据手册。
2. 由设计保证, 不在生产中测试。
3. $t_{SU(HSE)}$ 是从启用 (通过软件) 到时钟振荡达到稳定的启动时间, 针对标准晶体/谐振器测量的, 不同晶体/谐振器可能会有很大差异。
4. 数据基于考核结果, 不在生产中测试。

5.3.6.4. 外部低速晶体

可以通过外接 32.768 kHz 的晶体/陶瓷谐振器。在应用中, 晶体和负载电容应该尽可能靠近管脚, 这样可以使输出变形和启动稳定时间最小化。

表 5-15 外部低速晶体特性

符号	参数	条件 ⁽¹⁾	最小值 ⁽²⁾	典型值	最大值 ⁽²⁾	单位
$I_{CC}^{(4)}$	LSE 功耗	$C_L=6\text{ pF}$ @ 32.768 kHz $LSE_DRIVER[1:0]=01$	-	0.7	-	μA
		$C_L=12\text{ pF}$ @ 32.768 kHz $LSE_DRIVER[1:0]=10$	-	1.1	-	
		$C_L=12\text{ pF}$ @ 32.768 kHz $LSE_DRIVER[1:0]=11$	-	1.3	-	
$t_{SU(LSE)}^{(3)(4)}$	启动时间	$LSE_STARTUP[1:0]=00$	-	3	-	s

1. 晶体/陶瓷谐振器特性基于制造商给出的数据手册。
2. 由设计保证, 不在生产中测试。
3. $t_{SU(LSE)}$ 是从启用 (通过软件) 到时钟振荡达到稳定的启动时间, 针对标准晶体/谐振器测量的, 不同晶体/谐振器可能会有很大差异。
4. 数据基于考核结果, 不在生产中测试。

5.3.7. 内部高频时钟源 HSI 特性

表 5-16 内部高频时钟源特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{HSI}	HSI 频率	-	-	4.0 8.0 16.0 22.12 24.0	-	MHz
$\Delta_{Temp(HSI)}$	HSI 频率温度漂移	$V_{CC}=1.7 \sim 5.5 \text{ V}, T_A=25 \text{ }^\circ\text{C}$	-1 ⁽²⁾	-	1 ⁽²⁾	%
		$V_{CC}=1.7 \sim 5.5 \text{ V}, T_A=0 \sim 85 \text{ }^\circ\text{C}$	-2 ⁽²⁾	-	2 ⁽²⁾	
		$V_{CC}=1.7 \sim 5.5 \text{ V}, T_A=-40 \sim 85 \text{ }^\circ\text{C}$	-4 ⁽²⁾	-	2 ⁽²⁾	
		$V_{CC}=1.7 \sim 5.5 \text{ V}, T_A=-40 \sim 105 \text{ }^\circ\text{C}$	-4 ⁽²⁾	-	4 ⁽²⁾	
$D_{HSI}^{(1)}$	占空比	-	45 ⁽¹⁾	-	55 ⁽¹⁾	%
$t_{Stab(HSI)}$	HSI 稳定时间	-	-	2	4 ⁽¹⁾	μs
$I_{CC(HSI)}^{(2)}$	HSI 功耗	4 MHz	-	110	-	μA
		8 MHz	-	120	-	
		16 MHz	-	170	-	
		22.12 MHz, 24 MHz	-	210	-	

- 由设计保证, 不在生产中测试。
- 数据基于考核结果, 不在生产中测试。

5.3.8. 内部低频时钟源 LSI 特性

表 5-17 内部低频时钟特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{LSI}	LSI 频率	-	-	32.768	-	kHz
$\Delta_{Temp(LSI)}$	LSI 频率温度漂移	$T_A=25 \text{ }^\circ\text{C}, V_{CC}=3.3 \text{ V}$	-3	-	3	%
		$V_{CC}=1.7 \sim 5.5 \text{ V}, T_A=0 \sim 85 \text{ }^\circ\text{C}$	-10 ⁽²⁾	-	10 ⁽²⁾	
		$V_{CC}=1.7 \sim 5.5 \text{ V}, T_A=0 \sim 105 \text{ }^\circ\text{C}$	-15 ⁽²⁾	-	15 ⁽²⁾	
		$V_{CC}=1.7 \sim 5.5 \text{ V}, T_A=-40 \sim 105 \text{ }^\circ\text{C}$	-20 ⁽²⁾	-	20 ⁽²⁾	
$t_{Stab(LSI)}^{(1)}$	LSI 稳定时间	-	-	150	-	μs
$I_{CC(LSI)}^{(1)}$	LSI 功耗	-	-	300	-	nA

- 由设计保证, 不在生产中测试。
- 数据基于考核结果, 不在生产中测试。

5.3.9. 锁相环 PLL 特性

表 5-18 锁相环特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{PLL_IN}	输入频率	$T_A=25 \text{ }^\circ\text{C}, V_{CC}=3.3 \text{ V}$	16 ⁽¹⁾	-	24 ⁽¹⁾	MHz

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
		PLL 2 倍频				
		$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 3.3\text{ V}$ PLL 3 倍频	22.12 ⁽¹⁾	-	24 ⁽¹⁾	MHz
f_{PLL_OUT}	输出频率	$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 3.3\text{ V}$	32 ⁽¹⁾	-	72	MHz
Jitter	周期抖动	-	-	-	0.3 ⁽¹⁾	ns
t_{LOCK}	锁存时间	$f_{PLL_IN} = 24\text{ MHz}$	-	15	40 ⁽¹⁾	μs

1. 由设计保证, 不在生产中测试。

5.3.10. 存储器特性

表 5-19 存储器特性⁽²⁾

符号	参数	条件	典型值	最大值 ⁽¹⁾	单位
t_{prog}	页编程时间	-	1.0	1.5	ms
t_{ERASE}	页/扇区/块擦除时间	-	3.5	4.5	ms
I_{CC}	页编程功耗	-	2.1	2.9	mA
	页/扇区/片擦除功耗	-	2.1	2.9	

1. 由设计保证, 不在生产中测试。

2. 在 Flash 擦写期间, 不能在 SRAM 中运行程序, 否则会导致 CPU 停止工作。

表 5-20 存储器擦写次数和数据保持

符号	参数	条件	最小值 ⁽¹⁾	单位
N_{END}	擦写次数	$T_A = -40 \sim 85^\circ\text{C}$	100	kcycle
		$T_A = 85 \sim 105^\circ\text{C}$	10	
t_{RET}	数据保持期限	10 kcycle $T_A = 55^\circ\text{C}$	20	Year

1. 数据基于考核结果, 不在生产中测试。

5.3.11. EFT 特性

表 5-21 EFT 特性

符号	参数	条件	等级
EFT to power	-	IEC61000-4-4	4A

5.3.12. ESD & LU 特性

表 5-22 ESD & LU 特性

符号	参数	条件	典型值	单位
$V_{ESD(HBM)}$	静态放电电压(人体模型)	ESDA/JEDEC JS-001-2017	6	kV
$V_{ESD(CDM)}$	静态放电电压(充电设备模型)	ESDA/JEDEC JS-002-2018	1	kV
LU	静态 Latch-up	JESD78E	200	mA

5.3.13. 端口特性

表 5-23 端口静态特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IH}	输入高电平电压	$V_{CC}=1.7 \sim 5.5 \text{ V}$	0.7 V_{CC}	-	-	V
V_{IL}	输入低电平电压	$V_{CC}=1.7 \sim 5.5 \text{ V}$	-	-	0.3 V_{CC}	V
$V_{hys}^{(1)}$	斯密特迟滞电压	-	-	200	-	mV
I_{lkg}	输入漏电流	-	-	-	1	μA
R_{PU}	上拉电阻	-	30	50	70	$\text{k}\Omega$
R_{PD}	下拉电阻	-	30	50	70	$\text{k}\Omega$
$C_{IO}^{(1)}$	引脚电容	-	-	5	-	pF
$t_{ns(EXTI)}^{(1)}$	输入滤波宽度	$ENI=1, ENS=1$	3	5	10	ns
$t_{ns(I2C)}^{(1)}$	$I^2\text{C}$ 输入滤波宽度	$ENI=1, EIIC=1$	50	140	250	ns

1. 由设计保证, 不在生产中测试。

表 5-24 输出电压特性⁽³⁾

符号	参数 ⁽¹⁾	条件	最小值	最大值	单位
$V_{OL}^{(2)}$	输出低电平	$GPIOx_OSPEEDR=11$	$I_{OL} = 8 \text{ mA}, V_{CC} \geq 2.7 \text{ V}$	-	0.4
			$I_{OL} = 4 \text{ mA}, V_{CC} = 1.8 \text{ V}$	-	0.5
$V_{OH}^{(2)}$	输出高电平	$GPIOx_OSPEEDR=11$	$I_{OH} = 8 \text{ mA}, V_{CC} \geq 2.7 \text{ V}$	$V_{CC} - 0.4$	-
			$I_{OH} = 4 \text{ mA}, V_{CC} = 1.8 \text{ V}$	$V_{CC} - 0.5$	-

1. IO 类型可参考引脚定义的术语和符号。
2. 数据基于考核结果, 不在生产中测试。
3. 对于所有输出的组合, 最大总电流 (包括 V_{OL} 或 V_{OH} 产生的电流总和) 不应超过表 5-2 电流特性中的最大额定值参数 $\Sigma I_{IO(PIN)}$ 。

5.3.14. ADC 特性

表 5-25 ADC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{CCA}	ADC 供电电压	-	1.8	-	5.5	V
V_{REF+}	正参考电压	$V_{REF+} = V_{CCA}$	V_{CCA}			V
		$V_{REF+} = V_{REFBUF}$	-	1.5	-	
			-	2.048	-	
			-	2.5	-	
V_{REF-}	负参考电压	-	0			V
I_{VCCA}	V_{CCA} 引脚电流	$f_s=1 \text{ Msps}$	-	350	-	μA
I_{VREF+}	V_{REF+} 引脚电流	$f_s=1 \text{ Msps}$	-	22	-	μA
$C_{ADC}^{(1)}$	内部采样和保持电容	-	-	5	8	pF
$R_{AIN}^{(1)(3)}$	外部输入阻抗	-	-	-	31	$\text{k}\Omega$
$R_{ADC}^{(1)}$	采样开关电阻	-	-	-	2.5	$\text{k}\Omega$

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f_{ADC}	转换时钟频率	$V_{CCA}=1.8 \sim 2.3 \text{ V}$	0.8	4	$8^{(2)}$	MHz
		$V_{CCA}=2.3 \sim 5.5 \text{ V}$	0.8	8	$16^{(2)}$	
f_s	采样速率	$V_{CCA}=1.8 \sim 2.3 \text{ V}$	0.05	-	0.5	Msps
		$V_{CCA}=2.3 \sim 5.5 \text{ V}$	0.05	-	1	
$t_{CAL}^{(1)}$	校准时间	$f_{ADC} = 16 \text{ MHz}$	4.375	-	7.4375	μs
			70	-	119	$1/f_{ADC}$
$t_{samp}^{(1)}$	采样时间	$f_{ADC}=16 \text{ MHz}$ $V_{CCA}=1.8 \sim 5.5 \text{ V}$	0.219	-	14.97	μs
			3.5	-	239.5	$1/f_{ADC}$
$t_{samp_int}^{(1)}$	内部通道采样建立时间 (V_{REFINT} , $V_{CCA}/3$, OPA 1~3, DAC 1~2)	-	20	-	-	μs
$t_{conv}^{(1)}$	总转换时间	$V_{CCA}=1.8 \sim 5.5 \text{ V}$	12	-	248	$1/f_{ADC}$
$t_{eoc}^{(1)}$	转换结束时间	$V_{CCA}=1.8 \sim 5.5 \text{ V}$		0.5		$1/f_{ADC}$

- 由设计保证, 不在生产中测试。
- 数据基于考核结果, 不在生产中测试。
- 公式 1: R_{AIN} 最大值公式

$$R_{AIN} < \frac{T_s}{f_{ADC} \times C_{ADC} \times \ln(2^N + 2)} - R_{ADC}$$

上述公式用于决定最大外部阻抗, 使得误差可以小于 1/4 LSB。其中 $N = 12$, 表示 12 位分辨率。

表 5-26 RAIN max for $f_{ADC}=16 \text{ MHz}^{(1)}$

T_s (cycles)	t_s (μs)	R_{AIN} Max ($\text{k}\Omega$)
3.5	0.21	0.3
5.5	0.34	1.9
7.5	0.46	3.5
13.5	0.84	8.3
28.5	1.78	20.4
41.5	2.59	30.9
134.5	8.41	-
239.5	14.96	-

- 由设计保证, 不在生产中测试。

表 5-27 ADC 精度⁽¹⁾⁽²⁾

符号	参数	条件	最小值	典型值	单位
ET	综合误差	$f_{ADC} = 16 \text{ MHz}$, $V_{CCA} = 1.8 \text{ V} \sim 5.5 \text{ V}$	± 6.5	± 10.0	LSB
EO	失调误差		± 1.3	± 3.0	LSB
EG	增益误差		± 2.6	± 5.0	LSB
DNL	微分线性误差		± 1.2	± 1.5	LSB
INL	积分线性误差		± 3.5	± 6.5	LSB

- ADC DC 测试之前先做校准。
- 数据基于考核结果, 不在生产中测试。

5.3.15. DAC 特性

表 5-28 DAC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{CCA}	DAC 供电电压	缓冲器开启	2.2	-	5.5	V
	DAC 供电电压	缓冲器关闭	2.2	-	5.5	
$R_{LOAD}^{(1)}$	输出阻性负载	缓冲器开启时相对 V_{SSA} 的电阻负载	5	-	-	k Ω
		缓冲器开启时相对 V_{CCA} 的电阻负载	15	-	-	
$R_O^{(1)}$	DAC 输出负载	缓冲器关闭时, 要使精度为 1%, DAC_OUT 与 V_{SSA} 之间的最小阻性 负载为 1.5 M Ω	-	-	15	k Ω
$C_{LOAD}^{(1)}$	输出容性负载	DAC_OUT 引脚上的最大容性负载 (缓冲器开启时)	-	-	50	pF
$DAC_{OUT_min}^{(1)}$	最小输出电压(缓冲器开启)	给出 DAC 的最大输出幅度	0.2	-	-	V
$DAC_{OUT_max}^{(1)}$	最大输出电压(缓冲器开启)		-	-	$V_{CCA} - 0.2$	V
$DAC_{OUT_min}^{(1)}$	最小输出电压(缓冲器关闭)	给出 DAC 的最大输出幅度	0	-	-	mV
$DAC_{OUT_max}^{(1)}$	最大输出电压(缓冲器关闭)		-	-	V_{CCA}	V
$I_{CCA}^{(1)}$	V_{CCA} 功耗 ⁽²⁾	无负载, 输入端中间代码(0x800)	-	-	900	μ A
		无负载, 在输入上的直 流消耗方面, 对应于 $V_{CCA} = 3.6$ V 时 的最差代码(0xF1C)	-	-	1200	
$DNL^{(2)}$	差分非线性	DAC 按 8 位配置时	-	-	± 1	LSB
		DAC 按 12 位配置时	-	-	± 3	
$INL^{(2)}$	积分非线性	DAC 按 8 位配置时	-	-	± 1	LSB
		DAC 按 12 位配置时	-	-	± 4	
$Offset^{(2)}$	失调误差	DAC 按 8 位配置时	-	-	± 3	LSB
		DAC 按 12 位配置时	-	-	± 12	
$Gain_{error}^{(2)}$	增益误差	DAC 按 12 位配置时	-	-	± 0.5	%
$t_{SETTLING}^{(2)}$	满幅输出建立时间	$C_{LOAD} \leq 50$ pF, $R_{LOAD} \geq 5$ k Ω (满刻度: 适用于 DAC_OUT 达到最 终值 ± 1 LSB 时, 最低输入代码与最高 输入代码之间的 10 位输入代码转 换)	-	4	10	μ s
$Update_{rate}^{(2)}$	采样率 (从代码 i 到 i+1LSB)	$C_{LOAD} \leq 50$ pF, $R_{LOAD} \geq 5$ k Ω	-	-	1	MS/s
$t_{WAKEUP}^{(2)}$	唤醒时间	$C_{LOAD} \leq 50$ pF, $R_{LOAD} \geq 5$ k Ω , 介于可能的最低值和最高值之间的输 入代码	-	6.5	10	μ s
$P_{SRR+}^{(1)}$	电源抑制比 (V_{CCA}) (静 态直流测量)	无 R_{LOAD} , $C_{LOAD} = 50$ pF	-	-67	-40	dB

1. 由设计保证, 不在生产中测试。

2. 数据基于考核结果, 不在生产中测试。

5.3.16. 比较器特性

表 5-29 比较器特性⁽¹⁾

符号	参数	条件		最小值	典型值	最大值	单位
V_{IN}	输入电压范围	-		0	-	V_{CCA}	V
V_{SC}	失调电压	-		-	± 5	± 10	mV
$I_{CCA(SCALER)}$	Scaler 静态电流	-		-	0.8	1	μA
t_{START_SCALER}	Scaler 启动时间	-		-	100	200	μs
t_{START}	启动时间	高速模式		-	-	5	μs
		中速模式		-	-	15	
t_D	比较延时	200 mV 阶跃	高速模式	-	50	150	ns
		100 mV 过驱动电压	中速模式	-	1500	2800	
		>200 mV 阶跃	高速模式	-	-	200	
		100 mV 过驱动电压	中速模式	-	-	2900	
V_{offset}	失调电压	-		-	± 5	± 10	mV
V_{hys}	迟滞电压	无迟滞功能		-	0	-	mV
		有迟滞功能		-	20	-	
I_{CCA}	迟滞电压	静态功耗	高速模式	-	250	-	μA
			中速模式	-	7	-	
		动态功耗, 输入信号为过驱动电压 100 mV, 50 kHz 的方波	高速模式	-	250	-	
			中速模式	-	8	-	

1. 由设计保证, 不在生产中测试。

5.3.17. 运算放大器特性

表 5-30 运算放大器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{CCA}	供电电压	-	2.2	-	5.5	V
V_i	输入电压	-	0	-	V_{CCA}	V
V_o	输出电压	-	0.2	-	$V_{CCA} - 0.2$	V
I_o	输出电流	-	-	-	2.2	mA
R_L	负载时间	-	5	-	-	$k\Omega$
t_{start}	初始化时间	$C_{LOAD} \leq 50 \text{ pF}, R_{LOAD} \geq 5 \text{ k}\Omega$	-	-	20	μs
V_{io}	输入失调电压	$C_{LOAD} \leq 50 \text{ pF}, R_{LOAD} \geq 5 \text{ k}\Omega$ $V_{com}=V_{CCA}/2$	-	± 6	-	mV
PM	相位裕度	$C_{LOAD} \leq 50 \text{ pF}, R_{LOAD} \geq 5 \text{ k}\Omega$ $V_{com}=V_{CCA}/2$	-	80	-	Deg
UGBW	单位增益宽	$C_{LOAD} \leq 50 \text{ pF}, R_{LOAD} \geq 5 \text{ k}\Omega$ $V_{com}=V_{CCA}/2$	-	10	-	MHz
SR	压摆率	-	-	7	-	$V/\mu s$

5.3.18. 温度传感器特性

表 5-31 温度传感器特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
$T_L^{(1)}$	V_{TS} 相对于温度的线性度	-	± 2	± 5	°C
Avg_Slope ⁽¹⁾	平均斜率	2.3	2.5	2.7	mV/°C
V_{30}	30 °C (± 5 °C)时的电压	0.742	0.76	0.785	V
$t_{START}^{(1)}$	进入连续运行模式的启动时间	-	70	120	μs
$t_{S_setup}^{(1)}$	当读取温度时的 ADC 采样时间	20	-	-	μs

- 由设计保证, 不在生产中测试。
- 数据基于考核结果, 不在生产中测试。

5.3.19. LCD 控制器特性

表 5-32 LCD 控制器特性

符号	参数	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
$I_{LCD}^{(1)(3)}$	LCD 工作电流	外部电阻驱动模式	-	0.6	-	μA
		内部低驱动电阻模式	-	4	-	
		内部中驱动电阻模式	-	7.5	-	
		内部高驱动电阻模式	-	10	-	
$R_H^{(2)}$	低驱动电阻	-	-	1080	-	kΩ
$R_M^{(2)}$	中驱动电阻	-	-	540	-	
$R_L^{(2)}$	高驱动电阻	-	-	360	-	
V_{LCDH}	LCD 可调最高电压	-	-	V_{CCA}	-	V
V_{LCD3}	LCD 最高电压	-	-	V_{LCDH}	-	
V_{LCD2}	LCD 2/3 电压	-	-	$2/3 V_{LCDH}$	-	
V_{LCD1}	LCD 1/3 电压	-	-	$1/3 V_{LCDH}$	-	
V_{LCD0}	LCD 最低电压	-	-	V_{SS}	-	
$\Delta V_{LCD}^{(3)}$	LCD 电压偏差	$T_A = -40 \sim 105$ °C	-	-	± 50	mV

- LCD 使能 $V_{CCA}=3.3$ V, 1/4 duty, 1/3 bias, 扫描频率为 256 Hz, 激活所有像素, 不外接 LCD 屏幕。
- 由设计保证, 不在生产中测试。
- 数据基于考核结果, 不在生产中测试。

5.3.20. 内置参考电压特性

表 5-33 内置参考电压 (V_{REFINT}) 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{REFINT}	内置参考电压	-	1.17	1.2	1.23	V
$t_{start_VREFINT}$	V_{REFINT} 的启动时间	-	-	10	15	μs
$T_{coeff_VREFINT}$	V_{REFINT} 温度系数	-	-	-	100 ⁽¹⁾	ppm/°C
I_{CCA}	V_{REFINT} 产生的电流损耗	-	-	12	20	μA

1. 由设计保证, 不在生产中测试。

5.3.21. ADC 内置参考电压特性

表 5-34 ADC 内置参考电压 (V_{REFBUF}) 特性⁽¹⁾

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{REFBUF25}$	2.5 V 内置参考电压	$T_A=25^\circ C, V_{CCA}=3.3 V$	2.48	2.5	2.53	V
$V_{REFBUF20}$	2.048 V 内置参考电压	$T_A=25^\circ C, V_{CCA}=3.3 V$	2.03	2.048	2.07	V
$V_{REFBUF15}$	1.5 V 内置参考电压	$T_A=25^\circ C, V_{CCA}=3.3 V$	1.49	1.5	1.51	V
$t_{start_VREFBUF}$	内置参考电压的启动时间	-	-	-	2	μs
$T_{coeff_VREFBUF}$	V_{REFBUF} 温度系数	$T_A=-40 \sim 105^\circ C$	-	-	120	$ppm/^\circ C$

1. 由设计保证, 不在生产中测试。

5.3.22. 定时器特性

表 5-35 定时器特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
$t_{res(TIM)}$	定时器分辨时间	-	1	-	$t_{TIMxCLK}$
		$f_{TIMxCLK} = 72 \text{ MHz}$	13.889	-	ns
f_{EXT}	CH1~CH4 的定时器外部时钟频率	-	-	$f_{TIMxCLK}/2$	MHz
		$f_{TIMxCLK} = 72 \text{ MHz}$	-	24	
Res_{TIM}	定时器分辨率	TIM1/3/14/15/16/17	-	16	bit
		TIM2	-	32	
$t_{COUNTER}$	选择内部时钟时 16 位计数器时钟周期	-	1	65536	$t_{TIMxCLK}$
		$f_{TIMxCLK} = 72 \text{ MHz}$	0.013889	913	μs

表 5-36 LPTIM 特性(时钟选择 LSI)

预分频	PRESC[2:0]	最小溢出值	最大溢出值	单位
/1	0	0.0305	1998.848	ms
/2	1	0.0610	3997.696	
/4	2	0.1221	8001.9456	
/8	3	0.2441	15997.3376	
/16	4	0.4883	32001.2288	
/32	5	0.9766	64002.4576	
/64	6	1.9531	127998.3616	
/128	7	3.9063	256003.2768	

表 5-37 IWDG 特性(时钟选择 LSI)

预分频	PR[2:0]	最小溢出值	最大溢出值	单位
/4	0	0.122	499.712	ms
/8	1	0.244	999.424	
/16	2	0.488	1998.848	
/32	3	0.976	3997.696	
/64	4	1.952	7995.392	
/128	5	3.904	15990.784	
/256	6 or 7	7.808	31981.568	

表 5-38 WWDG 特性(时钟选择 48 MHz PCLK)

预分频	WDGTB[1:0]	最小溢出值	最大溢出值	单位
1*4096	0	0.085	5.461	ms
2*4096	1	0.171	10.923	
4*4096	2	0.341	21.845	
8*4096	3	0.683	43.691	

5.3.23. 通讯口特性

5.3.23.1. I²C 总线接口特性

I²C 接口满足 I²C 总线 规格和用户手册的要求:

- 标准模式(Sm): 100 kbit/s
- 快速模式(Fm): 400 kbit/s

I²C SDA 和 SCL 管脚具有模拟滤波功能, 参见下表。

表 5-39 I²C 滤波器特性

符号	参数	最小值	最大值	单位
t_{AF}	限制过滤器抑制的尖峰持续时间 (短于限制持续时间的尖峰被抑制)	50	260	ns

5.3.23.2. 串行外设接口 SPI 特性

表 5-40 SPI 特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
f_{SCK} $1/t_{c(SCK)}$	SPI 时钟频率	主机模式	-	24	MHz
		从机模式	-	18	
$t_{r(SCK)}$ $t_{f(SCK)}$	SPI 时钟上升和下降时间	负载电容: C = 15 pF	-	6	ns
$t_{su(NSS)}$	NSS 建立时间	从机模式	$2*T_{pclk}$	-	ns
$t_{h(NSS)}$	NSS 保持时间	从机模式	$2*T_{pclk}$	-	ns
$t_{w(SCKH)}$ $t_{w(SCKL)}$	SCK 的高低电频时间	主机模式, presc = 2	$T_{pclk} - 2$	$T_{pclk} + 1$	ns
$t_{su(MI)}$ $t_{su(SI)}$	数据输入建立时间	主机模式	1	-	ns
		从机模式	3	-	
$t_{h(MI)}$	数据输入保持时间	主机模式	5	-	ns
$t_{h(SI)}$		从机模式	2	-	
$t_{a(SO)}$	数据输出访问时间	从机模式	0	$3*T_{pclk}$	ns
$t_{dis(SO)}$	数据输出结束时间	从机模式	$2*T_{pclk}$	-	ns
$t_{v(SO)}$	数据输出有效时间	从机模式 (使能有效沿之后)	0	20	ns
$t_{v(MO)}$	数据输出有效时间	主机模式 (使能有效沿之后)	-	5	ns
$t_{h(SO)}$	数据输出保持时间	从机模式 (使能有效沿之后)	2	-	ns
$t_{h(MO)}$		主机模式 (使能有效沿之后)	1	-	

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
DuCy(SCK)	SPI 从机输入时钟占空比	从机模式	45	55	%

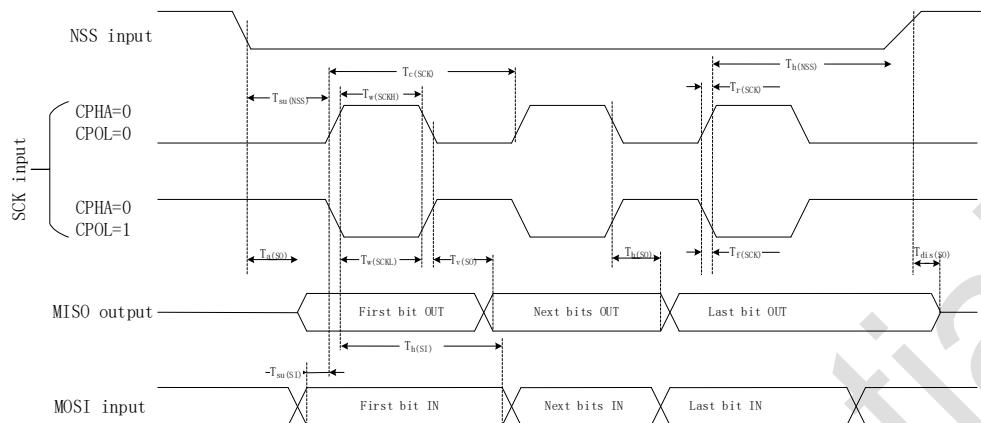


图 5-4 SPI 时序图 – 从机模式, CPHA = 0

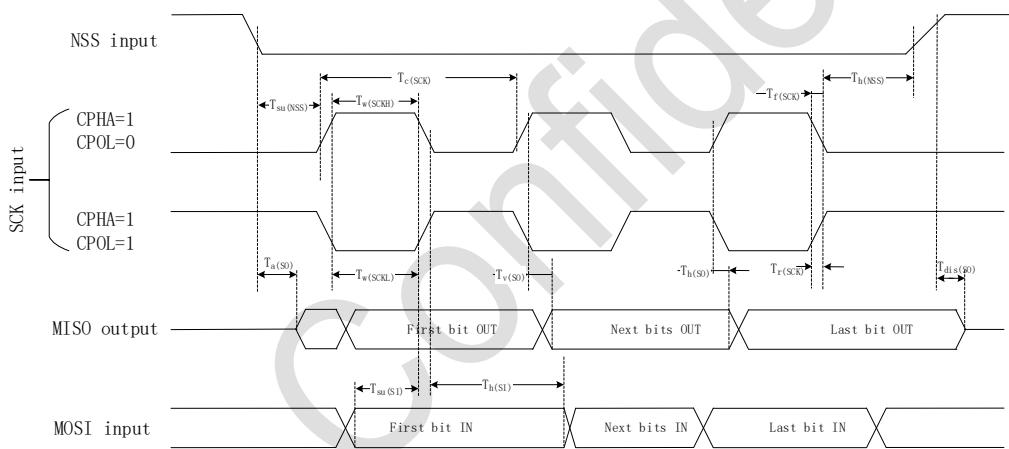


图 5-5 SPI 时序图 – 从机模式, CPHA = 1

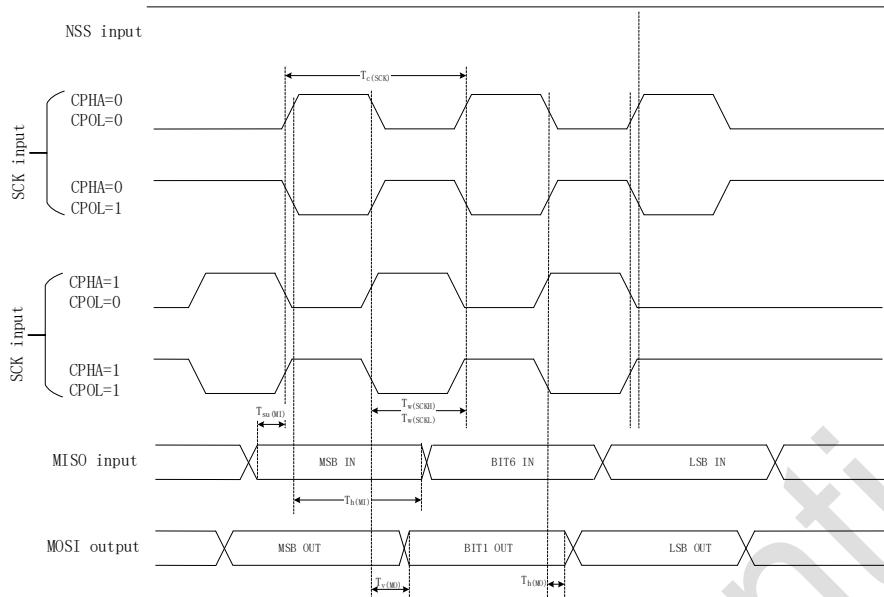
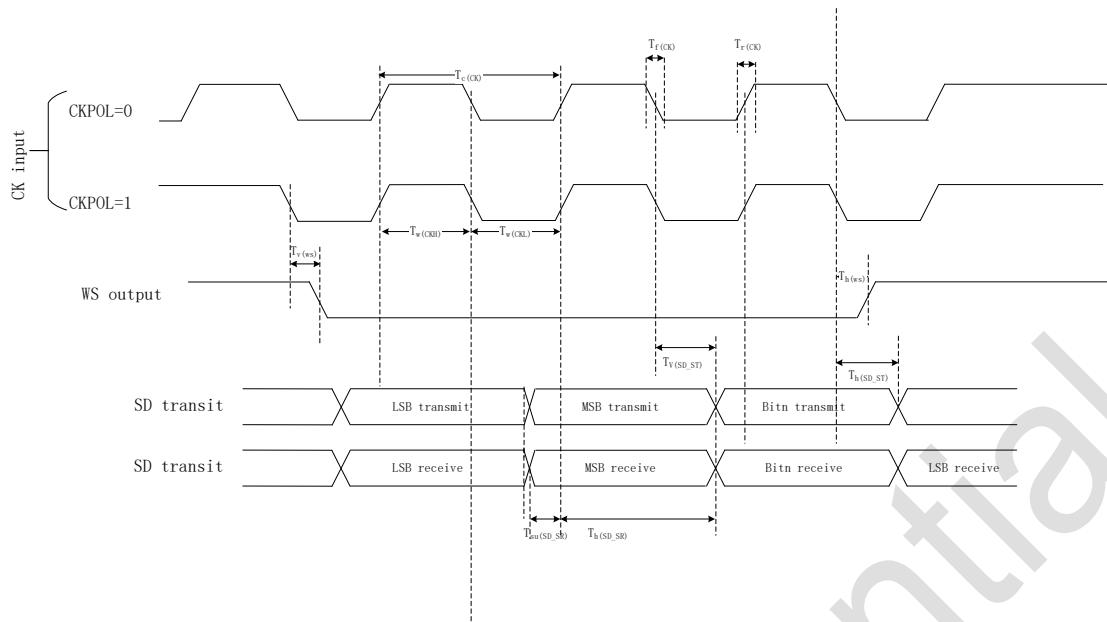
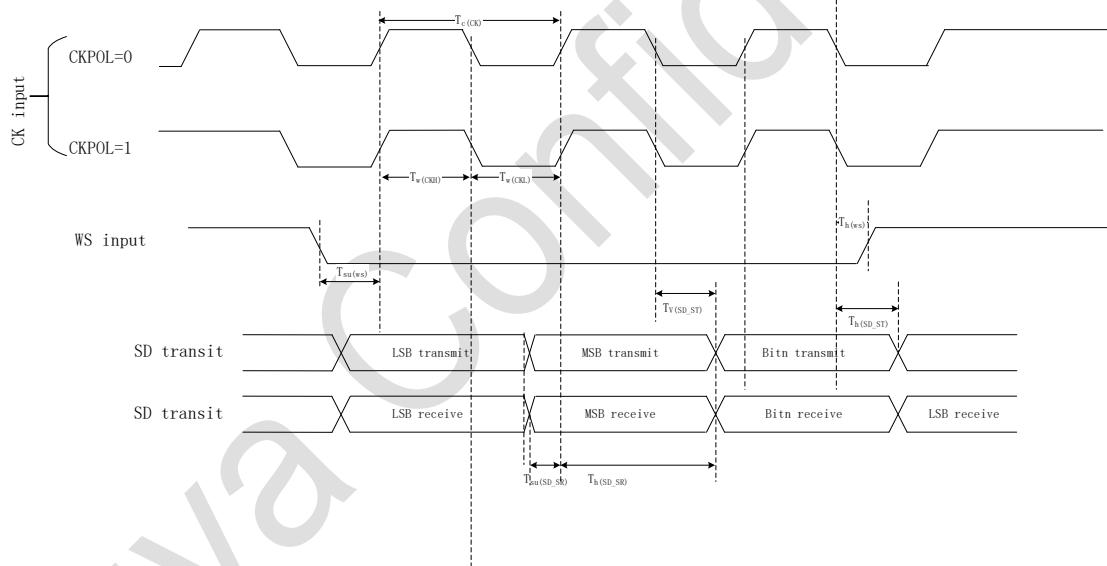


图 5-6 SPI 时序图 – 主机模式

5.3.23.3. I²S 接口特性

表 5-41 I²S 特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
f_{CK}	I ² S 时钟频率	主机模式(data:16 bits, 音频频率: 48 kHz)	1.597	1.601	MHz
		从机模式	0	7	
$t_{r(ck)}$	I ² S 时钟上升时间	负载电容: $C_L = 15 \text{ pF}$	-	5	ns
$t_{f(ck)}$	I ² S 时钟下降时间	负载电容: $C_L = 15 \text{ pF}$	-	6	
$t_{w(CKH)}$	I ² S 高电平时间	Master $f_{PCLK} = 16 \text{ MHz}$, 音频频率: 48 kHz	306	-	
$t_{w(CKL)}$	I ² S 低电平时间	Master $f_{PCLK} = 16 \text{ MHz}$, 音频频率: 48 kHz	312	-	
$t_{v(ws)}$	WS 有效时间	主机模式	2	-	
$t_{h(ws)}$	WS 保持时间	主机模式	2	-	
$t_{su(ws)}$	WS 建立时间	从机模式	7	-	
$t_{h(ws)}$	WS 保持时间	从机模式	1	-	
$t_{su(SD_MR)}$	数据输入建立时间	主机模式	11.5	-	
$t_{su(SD_SR)}$		从机模式	2	-	
$t_{h(SD_MR)}$	数据输入保持时间	主机模式	0	-	
$t_{h(SD_SR)}$		从机模式	0	-	
$t_{v(SD_MT)}$	数据输出有效时间	主机模式	-	17	
$t_{v(SD_ST)}$		从机模式	-	9	
$t_{h(SD_MT)}$	数据输出保持时间	主机模式	4	-	
$t_{h(SD_ST)}$		从机模式	6	-	
DuCy(sck)	I ² S 从机输入时钟占空比	从机模式	45	55	%

图 5-7 I²S 时序图 – 主机模式 (Philips 协议)图 5-8 I²S 时序图 – 主机模式 (Philips 协议)

5.3.23.4. USB 接口特性

表 5-42 USB 管脚特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{CCA}	USB 收发器工作电压	-	3.0	-	3.6	V
R_{PUUSB1} ⁽¹⁾	母线空闲时的上拉电阻	$USB_IDLE=1$	900	1200	1500	Ω
R_{PUUSB2} ⁽¹⁾	传输时的上拉电阻	$USB_IDLE=0$	1500	2200	3000	Ω

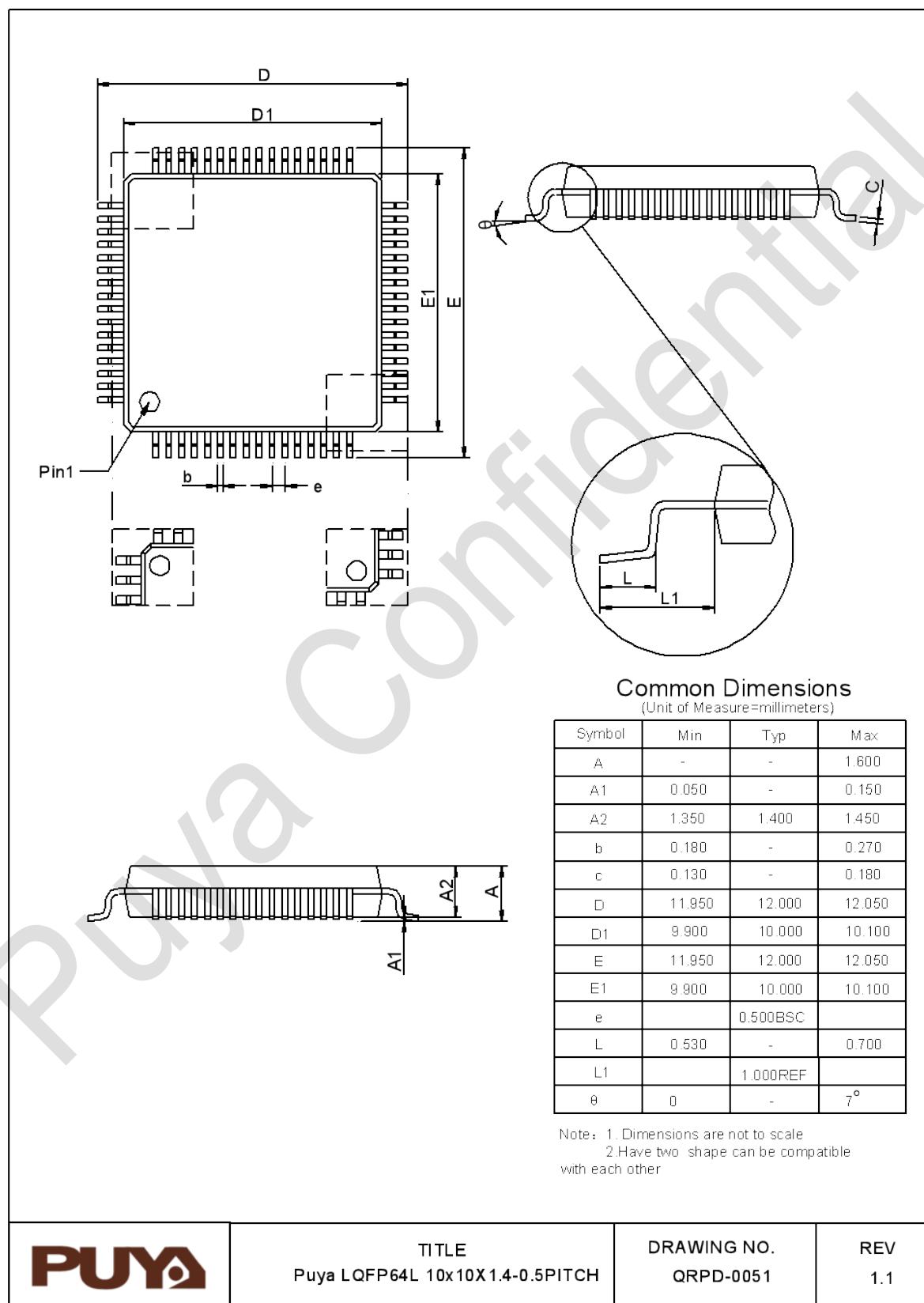
1. RPUUSB1, RPUUSB2 包括到 PAD 的 ESD 电阻。

表 5-43 USB AC 特性

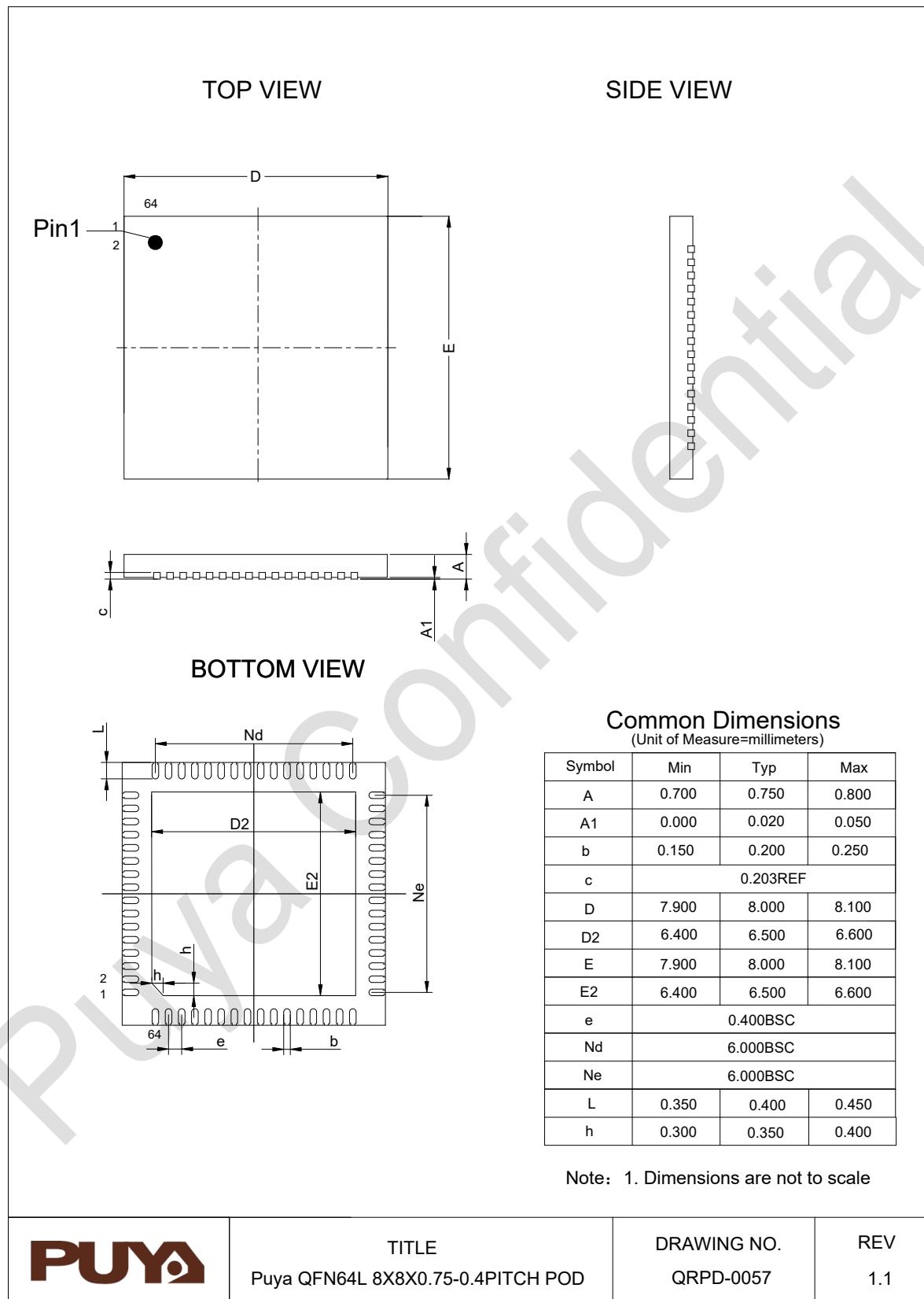
符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
t_{FR}	上升时间	$C_L=50 \sim 125 \text{ pF}$ 10% ~ 90% of $ V_{OH}-V_{OL} $	4	-	20	ns
t_{FF}	下降时间	$C_L=50 \sim 125 \text{ pF}$ 90% ~ 10% of $ V_{OH}-V_{OL} $	4	-	20	ns
FRFM	上升和下降时间匹配 (t_{FR}/t_{FF})	排除从空闲状态启动的第一次翻转	90	-	111.1	%
V_{CRS}	输出信号交叉电压	排除从空闲状态启动的第一次翻转	1.3	-	2.0	V

6. 封装信息

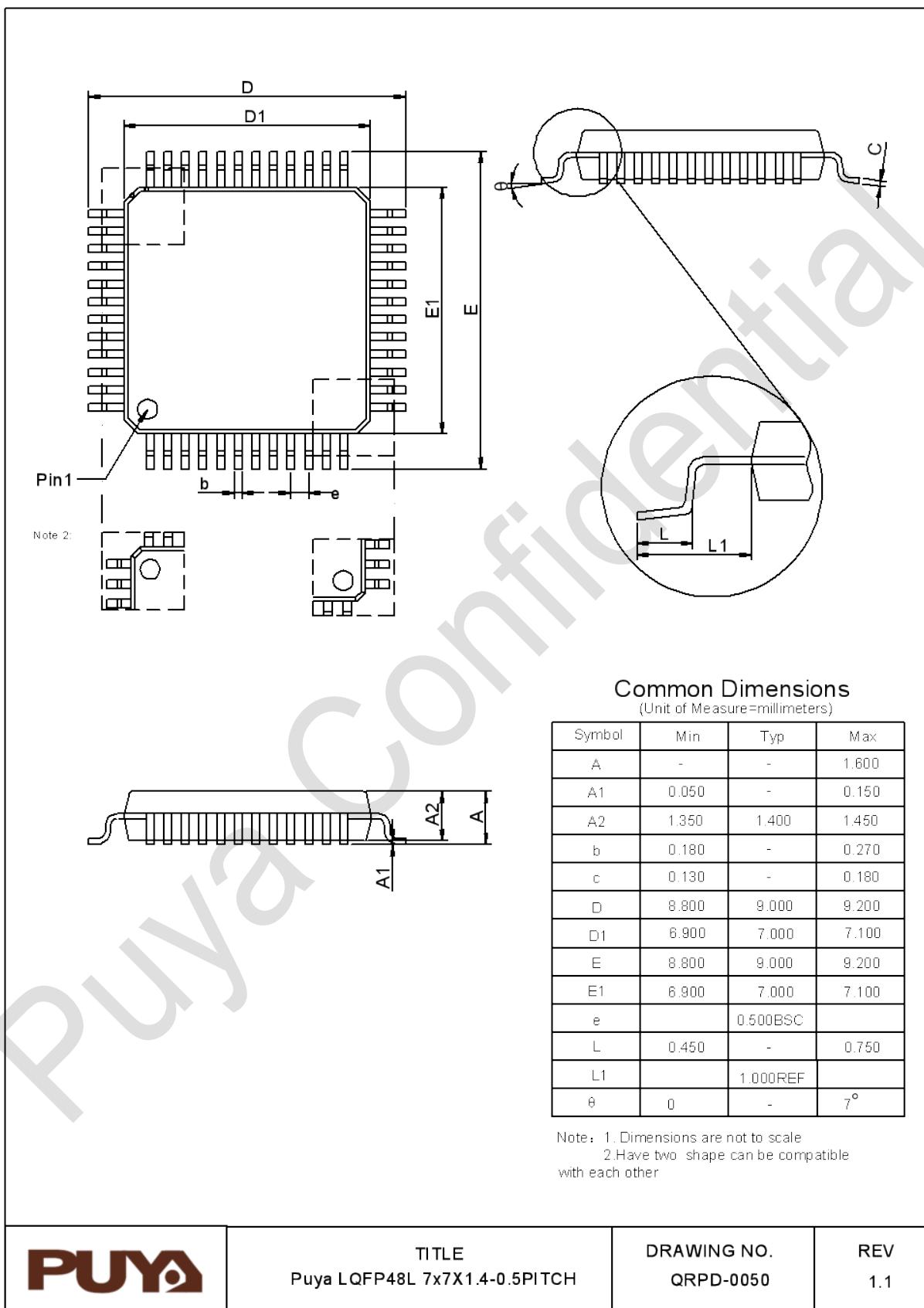
6.1. LQFP64 封装尺寸



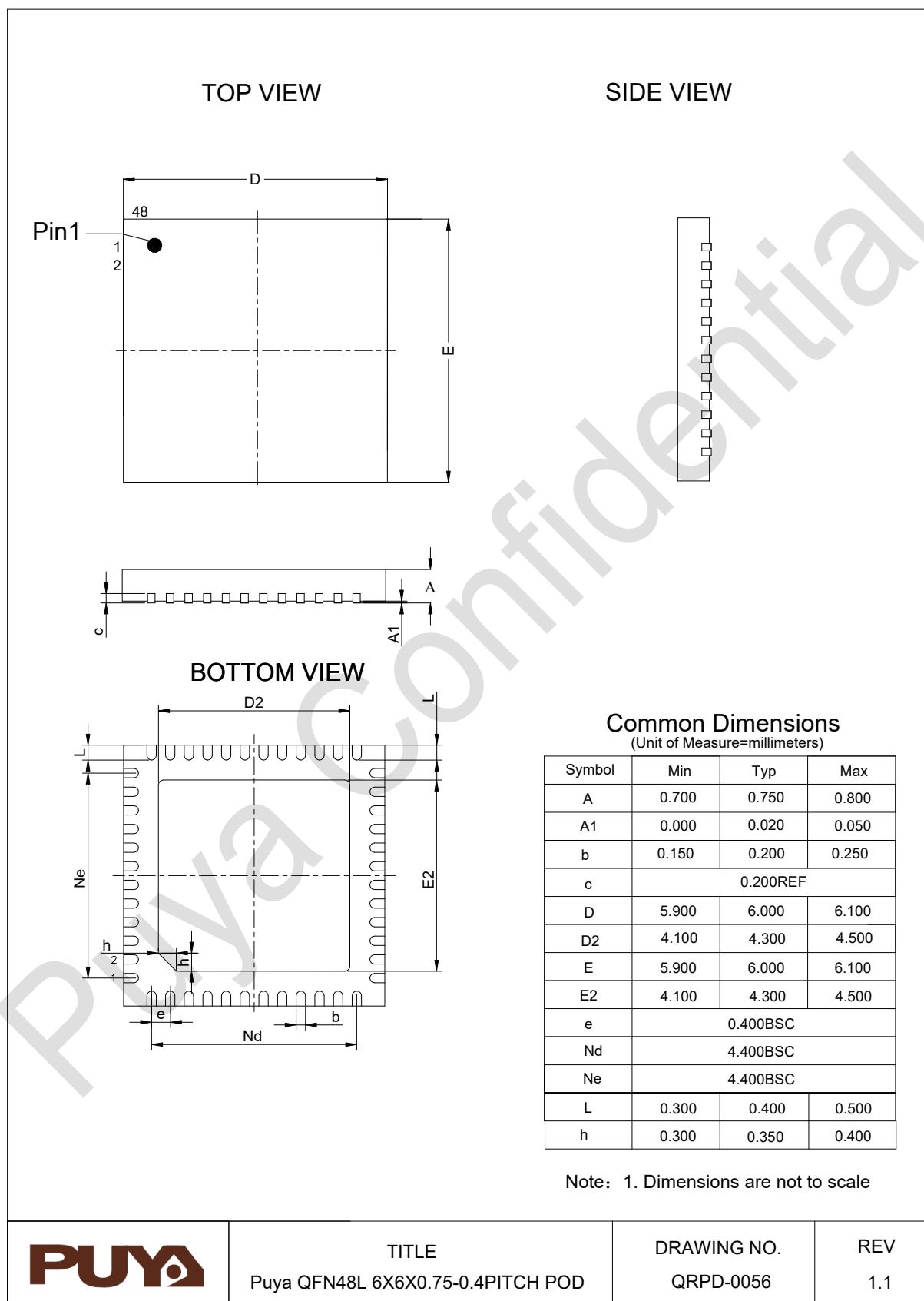
6.2. QFN64 封装尺寸



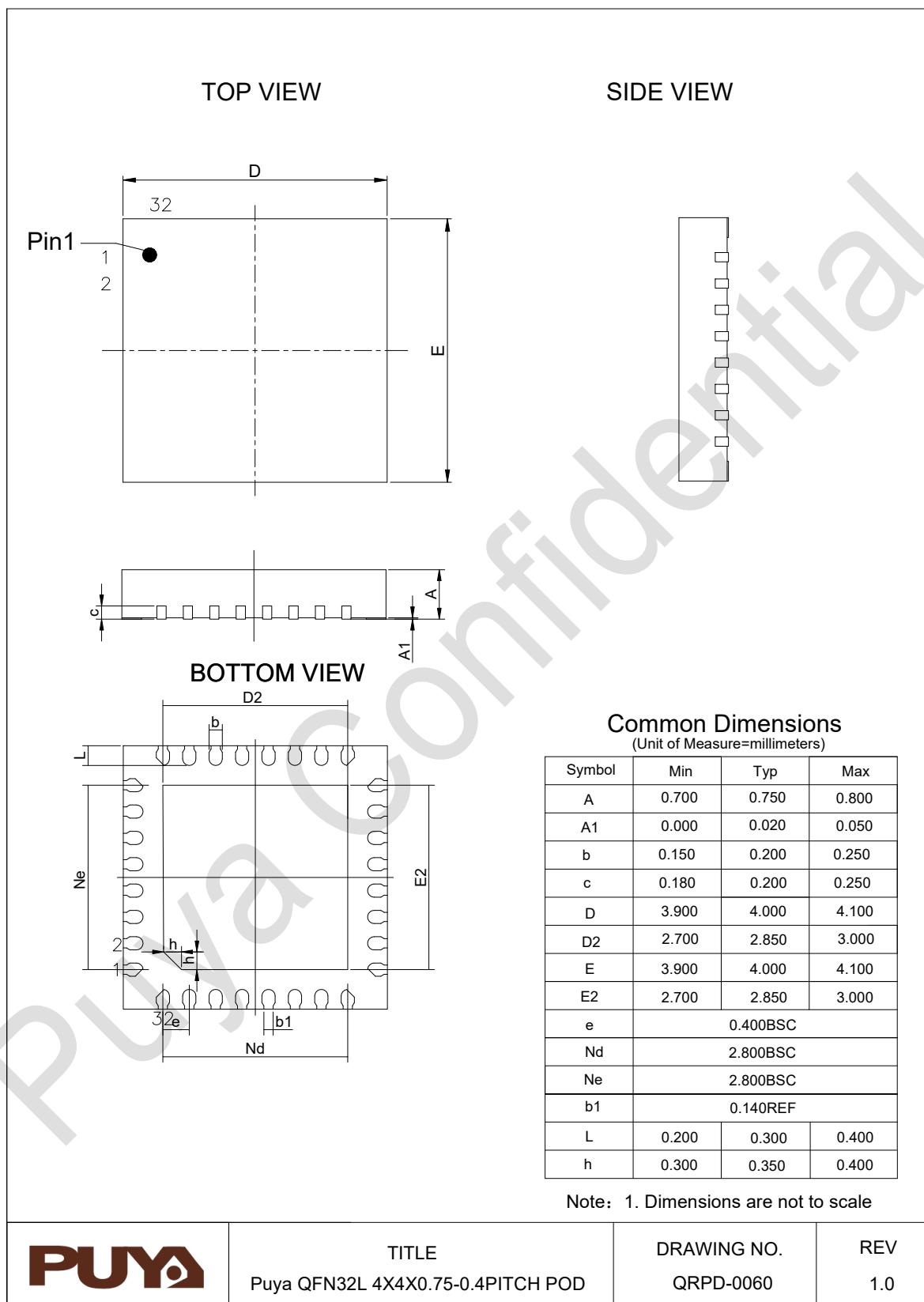
6.3. LQFP48 封装尺寸



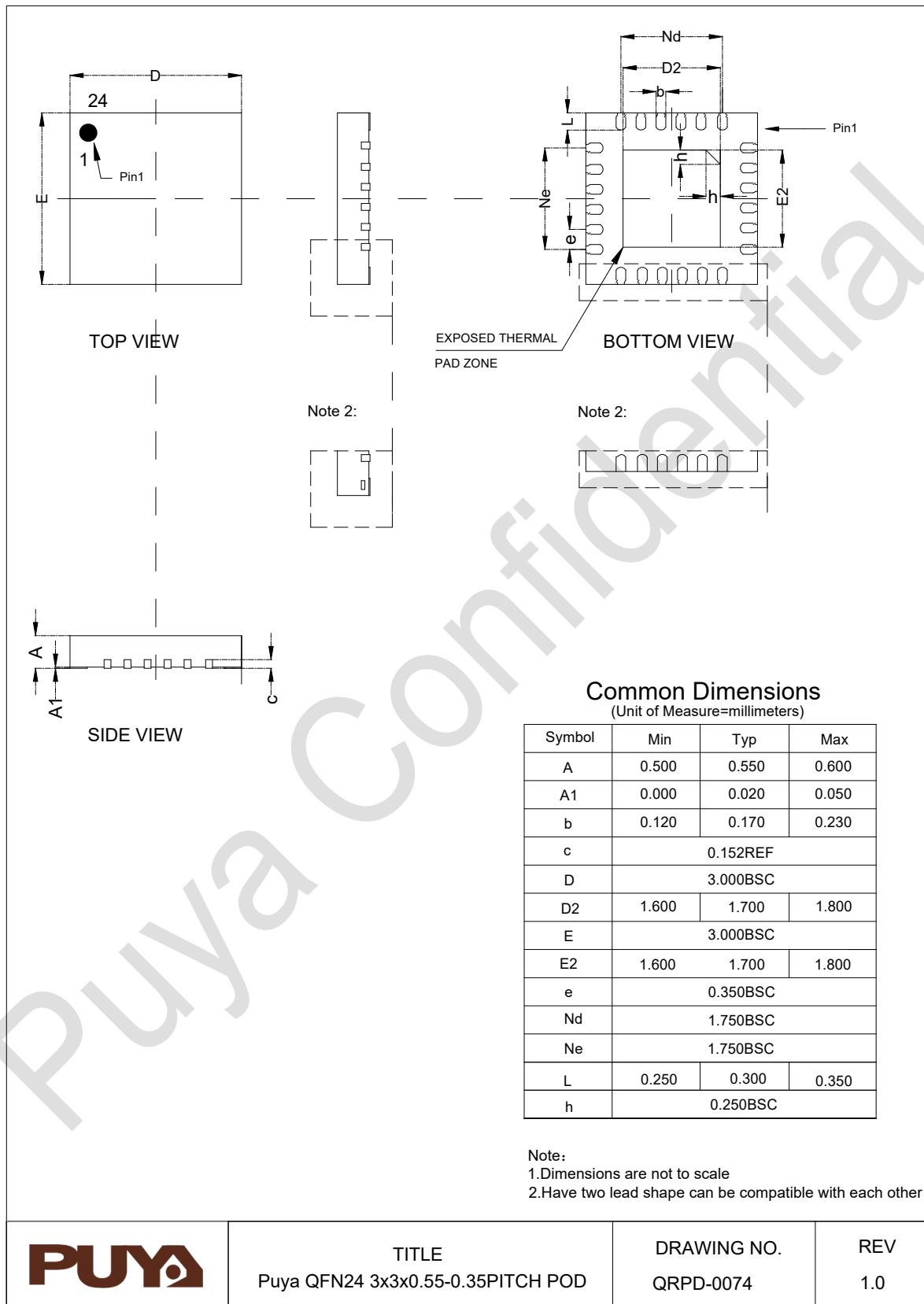
6.4. QFN48 封装尺寸



6.5. QFN32(4*4)封装尺寸



6.6. QFN24 封装尺寸



7. 订购信息

Example:	PY	32	F	071	R1	B	T	7	X	-	E
Company											
Product family	ARM® based 32-bit microcontroller										
Product type	F = General purpose										
Sub-family											
071 = PY32F071xx											
Pin count											
R1 = 64 pins Pinout1											
C1 = 48 pins Pinout1											
K3 = 32 pins Pinout3											
E1 = 24 pins Pinout1											
User code memory size											
B = 128 KB											
8 = 64 KB											
Package											
T = LQFP											
U = QFN											
Temperature range											
7 = -40 °C to + 105 °C											
6 = -40 °C to + 85 °C											
Options											
xxx = code ID of programmed parts(includes packing type)											
TR = tape and reel packing											
blank = tray packing											
Delimiter character											
Version											
E = Wafer version											

8. 版本历史

版本	日期	更新记录
V1.0	2024.12.25	1. 初版
V1.1	2025.02.11	1. 更新订购信息内容
V1.2	2025.02.21	1. 新增产品 PY32F071C1BU7-E
V1.3	2025.06.13	1. 更新表 5-31 温度传感器特性 2. 更新 ADC 内部通道采样建立时间 ($t_{\text{samp_int}}$)
V1.4	2026.01.13	1. 新增产品 PY32F071E18U7-E 2. 更新温度传感器特性值 3. 删除时钟安全功能



Puya Semiconductor Co., Ltd.

声 明

普冉半导体(上海)股份有限公司 (以下简称：“Puya”) 保留更改、纠正、增强、修改 Puya 产品和/或本文档的权利，恕不另行通知。用户可在下单前获取产品的最新相关信息。

Puya 产品是依据订单时的销售条款和条件进行销售的。

用户对 Puya 产品的选择和使用承担全责，同时若用于其自己或指定第三方产品上的，Puya 不提供服务支持且不对此类产品承担任何责任。

Puya 在此不授予任何知识产权的明示或暗示方式许可。

Puya 产品的转售，若其条款与此处规定不一致，Puya 对此类产品的任何保修承诺无效。

任何带有 Puya 或 Puya 标识的图形或字样是普冉的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代并替换先前版本中的信息。